

Bestätigungsvermerk

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005  
und Lagebericht

Süss MicroTec AG  
Garching



Bestätigungsvermerk

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005  
und Lagebericht

Süss MicroTec AG  
Garching

**Süss MicroTec AG  
Garching**

**Bilanz zum 31. Dezember 2005**

**A k t i v a**

**P a s s i v a**

	31.12.2005	31.12.2004		31.12.2005	31.12.2004
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	16.792.968,00	15.156.884,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	502.775,00	677.581,79	Bedingtes Kapital € 6.088.500		
2. Geleistete Anzahlungen	236.892,00	146.417,00	II. Kapitalrücklage	94.023.882,56	88.158.812,22
	739.667,00	823.998,79			
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.796,00	54.163,00	1. Gesetzliche Rücklage	35.338,09	35.338,09
III. Finanzanlagen			2. Andere Gewinnrücklagen	2.898.425,06	2.898.425,06
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	53.909.876,55	53.909.876,55		2.933.763,15	2.933.763,15
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	23.177.415,62	29.773.689,18	IV. Bilanzverlust	-14.579.436,95	-14.034.732,51
	77.087.292,17	83.683.565,73		<b>99.171.176,76</b>	<b>92.214.726,86</b>
	<b>77.876.755,17</b>	<b>84.561.727,52</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Pensionsrückstellungen	104.015,00	95.409,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon aus Lieferungen und Leistungen € 1.890.198,86; Vorjahr € 680.739,49)	17.946.216,30	16.882.451,36	2. Steuerrückstellungen	0,00	155.570,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr € 105.922,81; Vorjahr € 83.821,27)	557.653,09	787.657,17	3. Sonstige Rückstellungen	2.798.538,44	3.871.162,39
	18.503.869,39	17.670.108,53		<b>2.902.553,44</b>	<b>4.122.141,39</b>
II. Wertpapiere			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
Sonstige Wertpapiere	58.200,00	74.400,00	1. Anleihen (davon konvertibel € 3.995.020,00)	3.995.020,00	9.629.385,00
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	19.125.932,27	13.343.215,37	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.515.737,96; Vorjahr € 0,00)	2.515.737,96	1.250.000,00
	<b>37.688.001,66</b>	<b>31.087.723,90</b>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 33.924,83; Vorjahr € 307.516,33)	33.924,83	307.516,33
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>272.586,63</b>	<b>925.498,65</b>	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.142.359,36; Vorjahr € 4.884.177,79)	6.966.301,52	8.832.796,78
			5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 252.628,95; Vorjahr € 218.383,71; davon aus Steuern € 161.204,97; Vorjahr € 131.056,46; davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 23.169,68; Vorjahr € 27.312,52)	252.628,95	218.383,71
				<b>13.763.613,26</b>	<b>20.238.081,82</b>
	<b>115.837.343,46</b>	<b>116.574.950,07</b>		<b>115.837.343,46</b>	<b>116.574.950,07</b>

**Süss MicroTec AG  
Garching**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005**

	<b>2005</b>	<b>2004</b>
	€	€
1. Umsatzerlöse	6.644.488,85	6.731.284,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.564.926,98	2.658.902,07
	<b>11.209.415,83</b>	<b>9.390.186,49</b>
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.271.597,25	-4.218.795,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 32.701,25; Vorjahr € 88.496,92)	-216.725,52	-299.230,82
	<b>-2.488.322,77</b>	<b>-4.518.026,80</b>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-204.220,26	-780.629,18
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.382.321,57	-8.209.494,25
6. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	205.027,13	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 2.486.494,51; Vorjahr € 2.485.112,24)	2.858.958,67	2.785.054,68
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-227.941,43	-68.365,35
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 305.398,52; Vorjahr € 350.824,44)	-1.545.501,41	-1.667.360,61
	<b>-9.295.998,87</b>	<b>-7.940.794,71</b>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-574.905,81</b>	<b>-3.068.635,02</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.682,25	-325.014,01
12. Sonstige Steuern	39.883,62	-23.687,01
<b>13. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-544.704,44</b>	<b>-3.417.336,04</b>
14. Verlustvortrag aus Vorjahr	-14.034.732,51	-10.617.396,47
<b>15. Bilanzverlust</b>	<b>-14.579.436,95</b>	<b>-14.034.732,51</b>

**Süss MicroTec AG, Garching**  
**Anhang für das Geschäftsjahr 2005**

**A. Allgemeine Angaben**

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Ergänzende Bilanzierungsvorschriften aus der Satzung bestehen nicht.

Die Süss MicroTec AG („SMT AG“ oder „Gesellschaft“) ist eine große Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 3 HGB.

**B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze unverändert zum Vorjahr angewandt:

Die Sachanlagen und die immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen linear und monatsgenau über die voraussichtliche Nutzungsdauer, wobei diese für Software drei bzw. fünf Jahre beträgt. Die Bemessung der Abschreibungen der anderen Anlagen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt unter Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von drei bis fünf Jahren. Der Abschreibungszeitraum richtet sich nach der steuerlich anerkannten, betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungspreisen bis je € 410 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Die Abgangsfiktion für die geringwertigen Wirtschaftsgüter beinhaltet den Abgang nach fünf Jahren.

Die Anteile an den verbundenen Unternehmen werden mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen werden mit dem Nennwert bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Kurzfristige Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Fremdwährungen werden zum Stichtagskurs angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen waren nicht erforderlich.

In Anlehnung an internationale Rechnungslegungsvorschriften (analog E-DRS 11) wird der Wert der gewährten Aktienoptionen im Personalaufwand und in der Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 2 HGB erfasst. Die entsprechende Dotierung wird zeitanteilig über den Leistungszeitraum von 2 bzw. 5 Jahren gemäß den bestehenden Aktienoptionsplänen verteilt.

In den Rückstellungen ist den erkennbaren Einzelrisiken angemessen Rechnung getragen. Sie sind in der Höhe dotiert, wie dies nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Pensionsrückstellungen sind nach dem Teilwertverfahren gemäß § 6a EStG unter Zugrundelegung der Richttafeln von Dr. Klaus Heubeck (2005) und eines Zinssatzes von 6 % p.a. ermittelt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt. Bei der Umrechnung der kurzfristigen Fremdwährungsverbindlichkeiten wurde der Stichtagskurs angewendet.

Die Aufwendungen und Erträge der Gesellschaft sind entsprechend ihrer wirtschaftlichen Verursachung dem jeweiligen Geschäftsjahr zugeordnet.

**Süss MicroTec AG, Garching**  
**Anhang für das Geschäftsjahr 2005**

Zur Umrechnung von Fremdwährungspositionen in der Bilanz wurden die am Bilanzstichtag gültigen mittleren Devisenkurse verwendet. Bei langfristigen Fremdwährungspositionen wurde das Imparitätsprinzip beachtet. Sofern die Gründe für eine vorgenommene Fremdwährungsabwertung nicht mehr bestehen, erfolgt eine Zuschreibung entsprechend dem Wertaufholungsgebot. Im Geschäftsjahr 2005 wurden bei den Finanzanlagen aufgrund von Währungseffekten insgesamt Zuschreibungen von T€ 1.256 vorgenommen.

**C. Erläuterungen und Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses**

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens einschließlich der Abschreibungen im Geschäftsjahr sind dem Anlagenspiegel, der Bestandteil dieses Anhangs ist, zu entnehmen. Gegenüber dem Vorjahr erfolgte innerhalb des Anlagenspiegels ein geänderter Ausweis der Abwertungen und Zuschreibungen betreffend Ausleihungen an verbundenen Unternehmen aufgrund von Fremdwährungseffekten. Die Abwertungen bzw. Zuschreibungen werden ab dem Geschäftsjahr 2005 bei den Kumulierten Ab-/Zuschreibungen erfasst (im Vorjahr: Historische Anschaffungskosten). Die Vortragswerte zum 1.1.2005 wurden entsprechend angepasst.

Die Gesellschaft hat im Vorjahr mit der Süss MicroTec S.A.S. einen Forderungsverzicht mit Besserungsschein vereinbart. Die SMT AG hat auf einen Teil ihrer Ausleihungen in Höhe von € 1.500.000 verzichtet. Gemäß Besserungsklausel hat sich die SMT S.A.S. verpflichtet, den Darlehensbetrag in voller Höhe zurück zu erstatten, sobald das Eigenkapital dafür ausreicht. Im Geschäftsjahr konnte die SMT S.A.S. ihre Eigenkapitalposition nicht wesentlich verbessern, so dass keine Rückzahlung erfolgte.

Die Gesellschaft hat ein Festgeldguthaben mit einem Wert von € 1,0 Mio. an das Bankhaus Reuschel & Co. verpfändet. Die Verpfändung haftet für alle seit dem 29. Juli 2005 begründeten, künftigen und bedingten Ansprüche, die dem Bankhaus aus einer geschlossenen Rahmenvereinbarung für Finanztermingeschäfte zustehen.

Ein weiteres Kontoguthaben in Höhe von € 0,9 Mio. wurde an die Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG verpfändet. Die Verpfändung haftet für alle Ansprüche aus einem Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte.

Aus dem im Vorjahr mit der IBM Deutschland Kreditbank GmbH geschlossenen Darlehensvertrag über eine Darlehenssumme in Höhe von € 3.350.000 wurde im Geschäftsjahr ein weiterer Teilbetrag in Höhe von € 1.250.000 ausbezahlt. Der Darlehensbetrag dient zur Finanzierung der Entwicklung einer Produktionsmaschine gemäß Joint Development Agreement mit der IBM Corporation, USA. Es wurde ein variabler Zinssatz in Höhe des Ein-Monats-Euribors zuzüglich 5,15% p.a. vereinbart. Die Auszahlung des Darlehens richtet sich nach dem Projektfortschritt. Zum Bilanzstichtag waren insgesamt € 2.500.000 ausgezahlt. Das Darlehen ist spätestens am 30. Juni 2006 vollständig zurückzuführen.

Vertragsgemäß hat die Gesellschaft zum 31. Oktober 2005 einen Teilbetrag aus der im November 2003 begebenen Wandelanleihe in Höhe von € 5.634.365 zurückbezahlt. Zum Bilanzstichtag beläuft sich der Gesamtbetrag der Wandel- und Optionsanleihe noch auf insgesamt € 3.995.020.

Die Gesellschaft hat bei Ausgabe der Wandelanleihe im Jahr 2003 den für das Wandlungsrecht zugeflossenen Betrag als Aufgeld in die Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 2 HGB eingestellt. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem passivierten Rückzahlungsbetrag der Anleihe und dem Ausgabebetrag einer reinen Anleihe ohne Wandlungsrecht wurde unter den Rechnungsabgrenzungsposten als Disagio nach § 250 Abs. 3 S. 1 HGB aktiviert. Das Disagio wird über die Laufzeit der Anleihe aufgelöst und beträgt zum 31. Dezember 2005 noch € 108.625,40 (i. Vj. 655.034,00).

**Süss MicroTec AG, Garching**  
**Anhang für das Geschäftsjahr 2005**

Das Gezeichnete Kapital wurde am 26. August 2005 aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage um € 1.456.084 auf € 16.612.968 erhöht. Der Bezugspreis für die neuen Aktien betrug € 4,70 pro Aktie. Insgesamt ergab sich aus der Kapitalerhöhung ein Brutto-Mittelzufluss von € 6,8 Mio.. Der Aufsichtsrat hat dieser Kapitalerhöhung zugestimmt. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2005 vollumfänglich gewinnberichtigt. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 6. September 2005.

Infolge der Ausübung von insgesamt 180.000 Bezugsrechten in den im Aktienoptionsplan 2002 vorgesehenen Ausübungszeiträumen wurde das Gezeichnete Kapital aus bedingtem Kapital 2002/II durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage um € 180.000 auf € 16.792.968 erhöht. Die Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister erfolgte im Januar 2006.

Das Gezeichnete Kapital beträgt zum Bilanzstichtag € 16.792.968 und ist in 16.792.968 Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Gezeichneten Kapital von € 1,00 eingeteilt.

Am 31. Dezember 2005 verfügt die Gesellschaft über ein genehmigtes Kapital in Höhe von € 6.022.358 (i. Vj. € 7.478.442) und über ein bedingtes Kapital in Höhe von insgesamt € 6.088.500.

#### **Entwicklung des bedingten Kapitals**

	<b>31.12.2005</b>	<b>31.12.2004</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Bedingtes Kapital 1999/I	267.500	306.555
Bedingtes Kapital 2002/II	271.000	490.500
Bedingtes Kapital 2002/I	1.500.000	1.500.000
Bedingtes Kapital 2004/I	3.300.000	3.300.000
Bedingtes Kapital 2005/I	750.000	0
<b>Gesamt</b>	<b>6.088.500</b>	<b>5.597.055</b>

#### **Bedingtes Kapital 1999/I**

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Bezugsrechte aus dem Aktienoptionsplan 1999 ausgeübt. Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 21. Juni 2005 wurde das bedingte Kapital 1999/I auf € 267.500 herabgesetzt. Es diente zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften.

#### **Bedingtes Kapital 2002/II**

Aus dem Aktienoptionsplan 2002 wurden im Geschäftsjahr 2005 180.000 Bezugsrechte ausgeübt. Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 21. Juni 2005 wurde das bedingte Kapital 2002/II auf € 451.000 herabgesetzt. Dieser Betrag verringerte sich durch die Ausübung von 180.000 Bezugsrechten im Geschäftsjahr auf € 271.000. Das bedingte Kapital 2002/II diente zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften.

#### **Bedingtes Kapital 2002/I**

Das bedingte Kapital 2002/I beträgt nach der im Vorjahr erfolgten Wandlung von 200.000 Schuldverschreibungen aus der im Jahr 2003 begebenen Wandelanleihe in Anteile an der Gesellschaft noch € 1.500.000. Der Vorjahresausweis wurde insofern angepasst. Das bedingte Kapital 2002/I, angepasst durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Juni 2004, ermächtigt den Vorstand zur Ausgabe von Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibungen.

**Süss MicroTec AG, Garching**  
**Anhang für das Geschäftsjahr 2005**

**Bedingtes Kapital 2004/I**

Zum 31. Dezember 2005 beläuft sich das bedingte Kapital 2004/I unverändert zum Vorjahresstichtag auf € 3.300.000. Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Juni 2004 zur Ausgabe von Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibungen ermächtigt.

**Bedingtes Kapital 2005/I**

Auf der Hauptversammlung am 21. Juni 2005 wurde die Schaffung eines bedingten Kapitals 2005/I in Höhe von € 750.000 beschlossen. Es dient zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften (Aktienoptionsplan 2005). Aus diesem Teil des bedingten Kapitals wurden bis zum 31. Dezember 2005 insgesamt 193.000 Bezugsrechte ausgegeben.

Die Kapitalrücklage erhöhte sich im Geschäftsjahr durch das Agio aus der Kapitalerhöhung um € 5.387.510,80 und durch die Ausübung von Aktienoptionen um € 19.800,00. Zudem wurden der Kapitalrücklage aus der Gewährung von Bezugsrechten im Rahmen der bestehenden Aktienoptionspläne € 457.759,54 (i. Vj. € 749.856,04) ergebniswirksam als Personalaufwand zugeführt. Die Zuführungsbeträge für die Aktienoptionen errechnen sich aus dem Zeitwert der Optionen im Zeitpunkt der Ausgabe. Sie werden der Kapitalrücklage ratierlich über den Leistungszeitraum zugeführt. Der Zeitwert wird mit Hilfe der Black & Scholes – Methode ermittelt. Zum Bilanzstichtag beträgt die Kapitalrücklage insgesamt € 94.023.882,56.

Die Gesellschaft hat den Bilanzverlust des Vorjahres in Höhe von € 14.034.732,51 auf neue Rechnung vorgetragen. Zusammen mit dem Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2005 in Höhe von € 544.704,44 weist die SMT AG einen Bilanzverlust zum 31. Dezember 2005 in Höhe von € 14.579.436,95 aus.

**Die sonstigen Rückstellungen betreffen:**

	<b>31.12.2005</b>	<b>31.12.2004</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Drohende Verluste aus Devisentermingeschäften	535.559	0
Personalarückstellungen	365.092	1.902.142
Ausstehende Rechnungen	175.181	266.708
Jahresabschlusskosten	103.169	97.669
Rückzahlung von Fördermitteln	58.200	74.400
Aufsichtsratsvergütung	55.160	55.160
Geschäftsbericht	40.000	40.000
Sonstige Risiken	1.466.177	1.435.083
<b>Gesamt</b>	<b>2.798.538</b>	<b>3.871.162</b>



**Süss MicroTec AG, Garching**  
**Anhang für das Geschäftsjahr 2005**

**Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen:**

	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</b>	<b>Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</b>	<b>Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Anleihen	3.995.020	3.621.750	373.270	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.515.738	2.515.738	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.925	33.925	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.966.302	3.142.359	3.823.943	0
Sonstige Verbindlichkeiten	252.628	252.628	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>13.763.613</b>	<b>9.566.400</b>	<b>4.197.213</b>	<b>0</b>

Nach der zum 31. Oktober 2005 geleisteten Rückzahlung eines Teils der Wandelanleihe in Höhe von € 5.634.365 beläuft sich der Gesamtbetrag der im November 2003 begebenen Wandel- und Optionsanleihe zum Bilanzstichtag noch auf insgesamt € 3.995.020. Hiervon entfallen € 3.621.750 auf eine Wandelanleihe, die mit 6% p.a. verzinst wird und in voller Höhe am 30. April 2006 rückzahlbar ist, sofern sie nicht während dieser Laufzeit in bis zu 919.810 Aktien der Süss MicroTec AG umgewandelt wird. Der Wandlungspreis beträgt hierfür € 9,5967 pro Aktie. Die Süss MicroTec AG kann den Umtausch von bis zu 30% des Nennbetrages verlangen, wenn der Aktienkurs während 23 von 25 aufeinander folgenden Handelstagen bei mehr als 140% des Wandlungspreises liegt. Ein Umtausch von bis zu 50% des Nennbetrages kann von der Gesellschaft verlangt werden, wenn der Aktienkurs während 23 von 25 aufeinander folgenden Handelstagen bei mehr als 200% des Wandlungspreises liegt.

Des Weiteren entfallen EUR 373.270 auf eine Optionsanleihe, die gleichfalls mit 6 % p.a. verzinst wird und, vorbehaltlich der Ausübung von Bezugsrechten auf Aktien, am 31. Oktober 2008 rückzahlbar ist. Die Optionsanleihe ist mit 373.270 Bezugsrechten auf je eine Aktie der Süss MicroTec AG verbunden. Der Bezugspreis je Aktie beträgt € 10,0561 und liegt um 5 % über dem Wandlungspreis. Er ist zahlbar durch Einreichung je einer Teilschuldverschreibung aus der Optionsanleihe zuzüglich Barzahlung von EUR 9,0561 je Aktie. Die Gesellschaft kann ab dem 4. November 2004 die Ausübung von 33 1/3% der Bezugsrechte verlangen, wenn der Aktienkurs an 20 aufeinander folgenden Handelstagen mehr als 135% über dem Bezugspreis liegt. Die komplette Ausübung des Bezugsrechte kann ab 4. November 2004 verlangt werden, wenn der Aktienkurs an 20 aufeinander folgenden Handelstagen mehr als 200% über dem Bezugspreis liegt.

**Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse betreffen die Weiterberechnung der bei der Süss MicroTec AG entstandenen Aufwendungen an die Unternehmen der Süss Gruppe.

**Süss MicroTec AG, Garching**  
**Anhang für das Geschäftsjahr 2005**

**Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen und Regionen**

Region	Management- verrechnungen EUR	Marketing- verrechnungen EUR	Versicherungs- verrechnungen EUR	Sonstige EUR
Deutschland	2.385.537	489.879	220.288	405.415
Frankreich	381.109	87.540	19.991	0
Amerika	1.041.920	349.544	90.356	123.501
Japan	257.136	57.298	30.818	4.179
Asien	558.768	5.568	10.147	14.200
Sonstige	80.462	17.085	13.748	0
<b>Gesamt</b>	<b>4.704.932</b>	<b>1.006.914</b>	<b>385.348</b>	<b>547.295</b>

**Sonstige betriebliche Erträge**

Im Wesentlichen ist diese Position durch Fremdwährungsgewinne in Höhe von € 3.175.493,88 sowie durch periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von € 807.361,82 geprägt.

**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

Die Abschreibungen enthalten keine außerplanmäßigen Abschreibungen. Im Vorjahr entfielen € 410.627,00 auf die außerplanmäßige Abschreibung von Software-Lizenzen.

**Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen durch die Weiterbelastung von Entwicklungsleistungen in Höhe von € 3.586.190,18 im Rahmen des C4NP-Projekts und durch Fremdwährungsverluste in Höhe von € 2.262.000,73 geprägt.

**Erträge aus Gewinnabführungsverträgen**

Die ausgewiesenen Erträge resultieren aus dem im Geschäftsjahr abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrag mit der Süss MicroTec Test Systems GmbH.

**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Die Position beinhaltet eine Abwertung der Ausleihungen an die MFI Technologies Corp. (MFI) in Höhe von € 211.741,43 sowie eine Abwertung von im Umlaufvermögen gehaltenen Aktien in Höhe von € 16.200,00. Die Ausleihungen an die MFI sind zum Bilanzstichtag vollständig abgeschrieben.

**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

Die Position enthält einen periodenfremden Steueraufwand in Höhe von € 9.682,25.

**Sonstige Steuern**

Die sonstigen Steuern enthalten periodenfremde Erträge in Höhe von € 168.058,54 und periodenfremde Aufwendungen in Höhe von € 67.916,57. Die periodenfremden Erträge stehen in Zusammenhang mit der Geltendmachung von Vorsteueransprüchen aus dem Börsengang der Gesellschaft sowie durchgeführten Kapitalerhöhungen. Ein Urteil des EuGH im Geschäftsjahr bestätigte die Auffassung der Gesellschaft.

**Süss MicroTec AG, Garching**  
**Anhang für das Geschäftsjahr 2005**

**D. Währungstermingeschäfte**

Die Süss MicroTec AG schließt Währungstermingeschäfte ab, um das Wechselkursrisiko aufgrund eingehender Zahlungen aus Warenlieferungen und Darlehenstilgungen in japanischen Yen und US-Dollar abzusichern. Zum Bilanzstichtag belief sich das Volumen an Fremdwährungstermingeschäften auf Verträge über insgesamt € 11.043.093,47 für den Verkauf von USD 13.730.000 sowie über USD 2.000.000 für den Verkauf von € 1.687.870,79 im Zeitraum von Januar 2006 bis Juli 2006. Der beizulegende Wert der USD-Termingeschäfte beträgt zum Bilanzstichtag € 13.249.671,80.

Das Volumen an Fremdwährungstermingeschäften zur Absicherung des japanischen Yen belief sich auf Verträge über € 2.039.760,94 für den Verkauf von YEN 272.250.000 im Zeitraum von Januar 2006 bis April 2006. Zum Bilanzstichtag beträgt der beizulegende Wert der Yen-Termingeschäfte € 1.949.520,48.

Für drohende Verluste aus abgeschlossenen Devisentermingeschäften wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung in Höhe von € 535.558,76 gebildet.

Die Bewertung der offenen Devisentermingeschäfte erfolgte mit den zum Stichtag gültigen Terminbewertungskursen der Banken. Für Spekulationszwecke werden keine Währungstermingeschäfte eingesetzt.

**E. Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und Beteiligungsunternehmen**

Die Süss MicroTec AG ist Konzernobergesellschaft.

Bezüglich der Angaben zu den Konzerngesellschaften verweisen wir auf die Anteilsbesitzliste, die Bestandteil dieses Anhangs ist.

**F. Sonstige Angaben**

Vorstand der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2005 war:

**Herr Dr. Stefan Schneidewind**, Moritzburg/OT Reichenberg, Vorstandsvorsitzender

Zuständigkeitsbereiche:

Forschung und Entwicklung, Patentwesen, Materialwirtschaft und Logistik, Produktion und Facility Management, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement und Umweltschutz, Vertrieb und Marketing, Konzernstrategie

**Herr Stephan Schulak**, Rohrbach, Vorstandsmitglied

Zuständigkeitsbereiche:

Finanz- und Rechnungswesen, Informatik, Investor Relations, Recht, Steuern und Versicherungen, Personal

Die Bezüge des Vorstandes enthalten fixe und variable Bestandteile. Als fixe Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder monatliche Gehaltszahlungen, Zuschüsse zur Sozialversicherung sowie einen Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit.

**Süss MicroTec AG, Garching**  
**Anhang für das Geschäftsjahr 2005**

Als kurzfristige variable Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder einen Jahresbonus, der sich an individuell festgelegten Zielen orientiert. Eine nachträgliche Änderung der definierten Ziele ist ausgeschlossen.

Die Bezüge bestehen zudem aus einer variablen Vergütungskomponente mit langfristiger, renditeorientierter Anreizwirkung in Form eines Aktienoptionsplans. Aufgrund der in 2000, 2001, 2003, 2004 und 2005 an Vorstände gewährten Optionen wurden im Geschäftsjahr 2005 TEUR 122 als Personalaufwand erfasst.

Die gesamte Barvergütung des Vorstands betrug im Geschäftsjahr € 671.363 (i. Vj. € 788.761). Neben dem bezogenen Fixgehalt (einschließlich der Zuschüsse zur Sozialversicherung und dem geldwerten Vorteil aus der privaten Nutzung des Firmenfahrzeugs) wurden Herrn Dr. Schneidewind und Herrn Schulak insgesamt € 45.715,30 bzw. € 36.459,26 aus der zum Vorjahresstichtag gebildeten Rückstellung für den variablen Gehaltsbestandteil ausbezahlt. Für Herrn Dr. Schneidewind hat die Gesellschaft zusätzlich Kosten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung in Höhe von € 21.791,31 getragen.

Für den Jahresbonus 2005 von Herrn Dr. Schneidewind und Herrn Schulak wurde im Geschäftsjahr eine Rückstellung von € 150.000 gebildet.

Zudem wurden an Herrn Dr. Schneidewind und Herrn Schulak jeweils 40.000 Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft ausgegeben. Der Marktwert pro Option betrug bei Ausgabe € 1,6152.

Diese Vergütungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Vorstandsmitglieder auf:

	<b>Dr. Stefan Schneidewind</b>	<b>Stephan Schulak</b>
<b>Barvergütung (in EUR):</b>		
Fixkomponente	287.499	233.864
Erfolgsabhängige Komponente	83.332	66.668
<b>Summe</b>	<b>370.831</b>	<b>300.532</b>
<b>Aktienoptionen:</b>		
Anzahl (Stück)	40.000	40.000
Ausübungspreis (EUR)	4,95	4,95

Aus einer im Vorjahr gebildeten Rückstellung wurde im Geschäftsjahr an Herrn Dr. Richter, dem im Vorjahr ausgeschiedenen Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft, eine Abfindungszahlung in Höhe von € 850.000 sowie eine Tantiemepaymentzahlung in Höhe von € 41.697,84 für das am 31. Dezember 2004 abgelaufene Geschäftsjahr geleistet. Zudem wurde die weitere Nutzung des Dienstwagens bis zum Ablauf des Leasingvertrages Mitte Juni 2005 vereinbart. Dafür fielen Leasingzahlungen in Höhe von € 8.793,06 an. Die Herrn Dr. Richter insgesamt gewährten 145.000 Aktienoptionen sind nicht mit dem Ende der Vorstandsbestellung verfallen. Sie können gemäß der geltenden Ausübungsvoraussetzungen bis zum 30. Juni 2008 ausgeübt werden.

Für ein weiteres ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft besteht eine Pensionsrückstellung von € 22.900.

Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr 2005:

**Dr. Winfried Süss**, München, Aufsichtsratsvorsitzender  
weitere Mandate: ISiT, Itzehoe, (Kurator)

**Thomas Schlytter-Henrichsen**, Kronberg/Taunus, Geschäftsführer,  
stellv. Aufsichtsratsvorsitzender

**Süss MicroTec AG, Garching**  
**Anhang für das Geschäftsjahr 2005**

**Dr. Christoph Schücking**, Frankfurt/Main, Rechtsanwalt und Notar

weitere Mandate: Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt a. M. (stellvertretender Vorsitzender des Gesellschafterausschusses)  
 Kennametal GmbH, Fürth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)  
 Kennametal Holding GmbH, Fürth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)  
 Kennametal Hertel Europe Holding GmbH, Fürth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)  
 Freudenberg & Co., Weinheim/Bergstraße (Mitglied im Gesellschafterausschuss)

**Prof. Dr. Anton Heuberger**, München, Professor an der TU CAU Kiel

weitere Mandate: West Steag Partners AG, Essen (Mitglied im Beirat)  
 IZET, Itzehoe (Mitglied im Beirat)  
 Sollith Batteries GmbH, Itzehoe, (Mitglied im Beirat)  
 Sensor Dynamics, Graz, Österreich (Mitglied im Aufsichtsrat)

**Dr. Thomas Sesselmann**, Tittmoning, Geschäftsführer (bis 21. Juni 2005)

weitere Mandate: Heidenhain Holding Inc., Wilmington, DE., USA (Mitglied Board of Directors)  
 Heidenhain Holding K.K., Tokio, Japan (Mitglied Board of Directors)  
 ACU-RITE Companies Inc., Jamestown, NY., USA (Mitglied Board of Directors)  
 Heidenhain K.K., Nagoya, Japan (Mitglied Board of Directors)  
 SUMTAK CORPORATION, Tokio, Japan (Mitglied Board of Directors)

**Dr. h. c. Horst Görtz**, Neu – Anspach, Kaufmann

**Peter Heinz**, Waterbury, Vermont, USA, Diplom-Kaufmann (ab 21. Juni 2005)

weitere Mandate: H&H Associates Inc. Waterbury, Vermont, USA (Mitglied im Aufsichtsrat)

Die Bezüge des Aufsichtsrats betragen im Berichtsjahr insgesamt € 42.180. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates verzichtete auf seine Bezüge. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten je € 7.669 und der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates erhielt € 11.504.

Das Mitglied des Aufsichtsrates Dr. Christoph Schücking ist Gesellschafter der Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle. Die Süss MicroTec AG erhält Rechtsberatung von dieser Kanzlei. Im Geschäftsjahr wurden durch CMS Hasche Sigle insgesamt € 74.326,11 abgerechnet.

Aktienbesitz des Aufsichtsrates	Aktienanzahl		Bezugsrechte	
	31.12.2005	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2004
Dr. Winfried Süss	1.131.000	1.025.000	0	0
Thomas Schlytter-Henrichsen	6.909	6.909	0	0
Dr. Christoph Schücking	500	500	0	0
Prof. Anton Heuberger	0	0	0	0
Peter Heinz	1.338	0	0	0
Dr. Thomas Sesselmann	0	0	0	0
Dr. h.c. Horst Görtz	3.894	3.894	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.143.641</b>	<b>1.036.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Süss MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2005 werden im Bundesanzeiger bekannt gegeben und bei dem Handelsregister München hinterlegt.

**Süss MicroTec AG, Garching**  
**Anhang für das Geschäftsjahr 2005**

Die Süss MicroTec AG stellt in Anwendung von § 315a HGB einen Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach IFRS auf. Der Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2005 werden im Bundesanzeiger veröffentlicht und bei dem Handelsregister des Amtsgerichts München hinterlegt.

**G. Honorare des Abschlussprüfers**

Die Honorare des Abschlussprüfers im Geschäftsjahr 2005 setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>2005 EUR</b>
Abschlussprüfung	95.500
Steuerberatung	51.870
Sonstige Leistungen	44.626
<b>Gesamt</b>	<b>191.996</b>

**H. Zahl der Beschäftigten**

Die Süss MicroTec AG hatte im Geschäftsjahr durchschnittlich 18 (i. Vj. 20) Beschäftigte. Neben den Mitgliedern des Vorstands handelt es sich um Mitarbeiter im Verwaltungsbereich.

**I. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse**

**Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten**

Zur Besicherung eines Forschungs- und Entwicklungskredites der Süss MicroTec Test Systems GmbH in Höhe von T€ 2.542 hat die Süss MicroTec AG ihre Anteile an der Süss MicroTec Lithography GmbH, an der Süss MicroTec Inc. und an der Süss MicroTec S.A.S. an die IKB-Bank verpfändet.

Für zwei Forschungs- und Entwicklungskredite der Süss MicroTec Lithography GmbH in Höhe von insgesamt T€ 2.557 hat die Süss MicroTec AG ihre Anteile an der Süss MicroTec Lithography GmbH, an der Süss MicroTec Inc. und an der Süss MicroTec S.A.S. an die IKB-Bank verpfändet.

Die Süss MicroTec AG haftet für Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft Image Technology Inc., Palo Alto, gegenüber Kreditinstituten in Höhe von USD 1,2 Mio.

Die Süss MicroTec AG hat Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen in Höhe von € 166.967 zur Absicherung von Pensionszusagen an Mitarbeiter verpfändet.

**Verbindlichkeiten aus Bürgschaften**

Die Süss MicroTec AG hat eine Rückbürgschaft für einen Kautionsversicherungsvertrag der Tochtergesellschaften Süss MicroTec Lithography GmbH, Süss MicroTec Test Systems GmbH und Süss MicroTec Laboratory Equipment GmbH mit einem Bürgschaftsrahmen in Höhe von € 2,5 Mio. übernommen.

Für zwei Mietkaufverträge der Süss MicroTec Lithography GmbH hat die Gesellschaft eine Bürgschaft abgegeben. Gegen monatliche Mietraten von insgesamt € 6.417 mietet die SMTL Klimaanlage sowie Reinraumausstattung. Die Verträge haben eine Laufzeit bis Ende 2008 bzw. Ende 2009.

**Süss MicroTec AG, Garching**  
**Anhang für das Geschäftsjahr 2005**

Die Süss MicroTec AG hat für einen Leasingvertrag der Süss MicroOptics S.A. gegenüber der Credit Suisse Leasing eine Garantie abgegeben. Gegen monatliche Mietraten von CHF 16.444,45 mietet die SMO eine Produktionsanlage. Der Leasingvertrag läuft bis Juni 2009.

**Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Die Süss MicroTec AG hat für die Süss MicroTec Test Systems GmbH eine Patronatserklärung bei Inanspruchnahme eines Barkredits in Höhe von € 520.000 abgegeben. Zum Bilanzstichtag ist der Barkredit nicht in Anspruch genommen.

Zur Absicherung einer Kreditlinie der SMT S.A.S in Höhe von T€ 500 hat die Süss MicroTec AG eine Patronatserklärung abgegeben. Die Kreditlinie ist zum Bilanzstichtag mit insgesamt T€ 265 in Anspruch genommen.

Für eine weitere Kreditlinie der SMT S.A.S. in Höhe von T€ 300 hat die Süss MicroTec AG ebenfalls eine Patronatserklärung abgegeben. Zum Bilanzstichtag ist die Linie mit insgesamt T€ 259 in Anspruch genommen.

Für die gleiche Gesellschaft hat die Süss MicroTec AG weitere Patronatserklärungen zur Absicherung bestehender Kredite gegenüber einem Bankenkonsortium abgegeben. Die SMT S.A.S nimmt zum 31. Dezember 2005 einen Kredit in Höhe von T€ 1.395 in Anspruch.

Des Weiteren besteht für die SMT S.A.S. eine Patronatserklärung zur Absicherung eines weiteren Kredits, der zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 112 in Anspruch genommen ist.

Für die finanzielle Absicherung der Unternehmensfortführung der Süss MicroTec Inc., Waterbury, bis September 2006 hat die Süss MicroTec AG eine Garantieerklärung abgegeben.

Die Süss MicroTec AG ist Mietverpflichtungen in Höhe von € 592.546 bis zum Jahr 2008 gegenüber der Süss MicroTec Lithography GmbH und Leasingverpflichtungen in Höhe von € 85.447,51 gegenüber Dritten bis zum Jahr 2007 eingegangen.

**J. Mitteilungen nach WpHG**

Die Nobel SA, 64 rue Galilée, 75008 Paris, hat der Gesellschaft gem. § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m. § 32 Abs. 2 InvG mitgeteilt, dass sie per 9. Mai 2005 die Schwelle von 5% der Stimmrechte an der Süss MicroTec AG unterschritten hat. Ihr Stimmrechtsanteil beträgt nun 4,69%.

Am 11. Mai 2005 teilte Julius Baer Multistock, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, der Süss MicroTec AG mit, dass sie per 4. Mai 2005 die Schwelle von 5% der Stimmrechte an der Gesellschaft unterschritten hat und seit diesem Zeitpunkt einen Stimmrechtsanteil von 4,97% hält.

**Süss MicroTec AG, Garching**  
**Anhang für das Geschäftsjahr 2005**

**K. Angabe der Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex nach § 161 AktG**

Vorstand und Aufsichtsrat der Süss MicroTec AG haben die nach § 161 AktG vorgeschriebene Entsprechenserklärung zur Beachtung des Deutschen Corporate Governance Kodex (Fassung vom 4. Juli 2003) im Dezember 2005 abgegeben und im Internet unter [www.suss.com](http://www.suss.com) dauerhaft zugänglich gemacht.

Garching, 15. März 2006

Dr. Stefan Schneidewind  
Vorsitzender des Vorstandes

Stephan Schulak  
Vorstandsmitglied



	Historische Anschaffungskosten				Kumulierte Ab- / Zuschreibungen					Buchwerte	
	01.01.2005	Zugänge	Abgänge	31.12.2005	01.01.2005	Zugänge	Zuschreibungen	Abgänge	31.12.2005	31.12.2005	01.01.2005
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.045.166,54	10.023,00	0,00	2.055.189,54	1.367.584,75	184.829,79	0,00	0,00	1.552.414,54	502.775,00	677.581,79
2. Geleistete Anzahlungen	146.417,00	90.475,00	0,00	236.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.892,00	146.417,00
	2.191.583,54	100.498,00	0,00	2.292.081,54	1.367.584,75	184.829,79	0,00	0,00	1.552.414,54	739.667,00	823.998,79
<b>II. Sachanlagen</b>											
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.303,21	15.757,40	6.275,00	212.785,61	149.140,21	16.877,92	0,00	3.028,52	162.989,61	49.796,00	54.163,00
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.584,78	2.512,55	0,00	21.097,33	18.584,78	2.512,55	0,00	0,00	21.097,33	0,00	0,00
	221.887,99	18.269,95	6.275,00	233.882,94	167.724,99	19.390,47	0,00	3.028,52	184.086,94	49.796,00	54.163,00
<b>III. Finanzanlagen</b>											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	55.882.591,54	0,00	0,00	55.882.591,54	1.972.714,99	0,00	0,00	0,00	1.972.714,99	53.909.876,55	53.909.876,55
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	39.811.772,47	1.290.354,69	9.673.848,07	31.428.279,09	10.038.083,29	211.741,43	1.256.491,24	742.470,01	8.250.863,47	23.177.415,62	29.773.689,18
	95.694.364,01	1.290.354,69	9.673.848,07	87.310.870,63	12.010.798,28	211.741,43	1.256.491,24	742.470,01	10.223.578,46	77.087.292,17	83.683.565,73
	98.107.835,54	1.409.122,64	9.680.123,07	89.836.835,11	13.546.108,02	415.961,69	1.256.491,24	745.498,53	11.960.079,94	77.876.755,17	84.561.727,52

**Süss MicroTec AG  
Garching**

**Entwicklung des Anteilsbesitzes im Geschäftsjahr 2005**

	Buchwerte				Eigenkapital		Beteiligungs- quote	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag Geschäftsjahr 2005	
	01.01.2005	Zugänge	Abgänge/ Abschreibungen	31.12.2005	Währung	Betrag		Währung	Betrag
	EUR	EUR	EUR	EUR			%		
Süss MicroTec Lithography GmbH, Garching	30.416.489,04	0,00	0,00	30.416.489,04	EUR	5.405.509	100,00%	€	-8.737.928,11
Süss MicroTec Test Systems GmbH, Sacka **	2.914.363,72	0,00	0,00	2.914.363,72	EUR	7.917.094	50,00%	€	212.981,41
Süss MicroTec Laboratory Equipment GmbH/ vormals Karl Süss GmbH, Singen *	63.064,12	0,00	0,00	63.064,12	EUR	207.216	100,00%	€	-1.243,38
Süss MicroOptics S.A., Neuchatel, Schweiz *	288.331,08	0,00	0,00	288.331,08	CHF	499.299	85,00%	CHF	91.668,21
Süss MicroTec KK, Yokohama, Japan	1.994.038,34	0,00	0,00	1.994.038,34	JPY	359.259.010	100,00%	JPY	-135.542.962,00
Süss MicroTec Ltd., Wokingham, Großbritannien *	2.300.813,47	0,00	0,00	2.300.813,47	GBP	1.405.681	100,00%	GBP	-23.265,00
Süss MicroTec S.A.S., St. Jeoire, Frankreich	1.519.126,79	0,00	0,00	1.519.126,79	EUR	1.785.449	100,00%	€	-70.076,00
Süss MicroTec Inc., Waterbury, USA	3.455.418,30	0,00	0,00	3.455.418,30	USD	8.970.401	100,00%	USD	-355.260,37
Image Technology Inc., Palo Alto, USA	10.529.034,54	0,00	0,00	10.529.034,54	USD	1.541.418	100,00%	USD	1.301.241,70
MFI Technologies Corp., San Jose, USA *	0,00	0,00	0,00	0,00	USD	-4.091.029	100,00%	USD	-242.273,52
Karl Süss GF GmbH, Garching *	28.121,05	0,00	0,00	28.121,05	EUR	39.417	100,00%	€	-1.496,68
Süss MicroTec Company Ltd., Bangkok, Thailand *	75.304,09	0,00	0,00	75.304,09	Baht	13.147.850	49,00%	Baht	818.800,00
Süss MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu *	135.531,36	0,00	0,00	135.531,36	TWD	13.717.656	100,00%	TWD	-13.320.024,00
Süss MicroTec Company Ltd., Shanghai, China *	190.240,65	0,00	0,00	190.240,65	CNY	3.832.721	100,00%	CNY	1.100.914,08
<b>Gesamt</b>	<b>53.909.876,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.909.876,55</b>					

\* ungeprüft

\*\* Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ergebnisabführung

## Konzernlagebericht und Lagebericht zum 31. Dezember 2005

### 1. Konzernstruktur und Geschäftstätigkeit

Der SÜSS MicroTec Konzern fertigt und vertreibt Anlagen und Prüfsysteme für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik.

Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halbleiterindustrie für den Labor- und den Produktionsbereich tätig. Wachstumsstarke Marktnischen bilden die Tätigkeitsschwerpunkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit langfristigem Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte und Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung.

Größere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren Einzelgeräten, wo die Gruppe mit internen und externen Partnern Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen bildet und nutzt.

Der Konzern ist in 5 Segmente eingeteilt, wobei das Segment Sonstige aus mehreren kleineren Teileinheiten besteht, die jeweils getrennt geleitet werden.

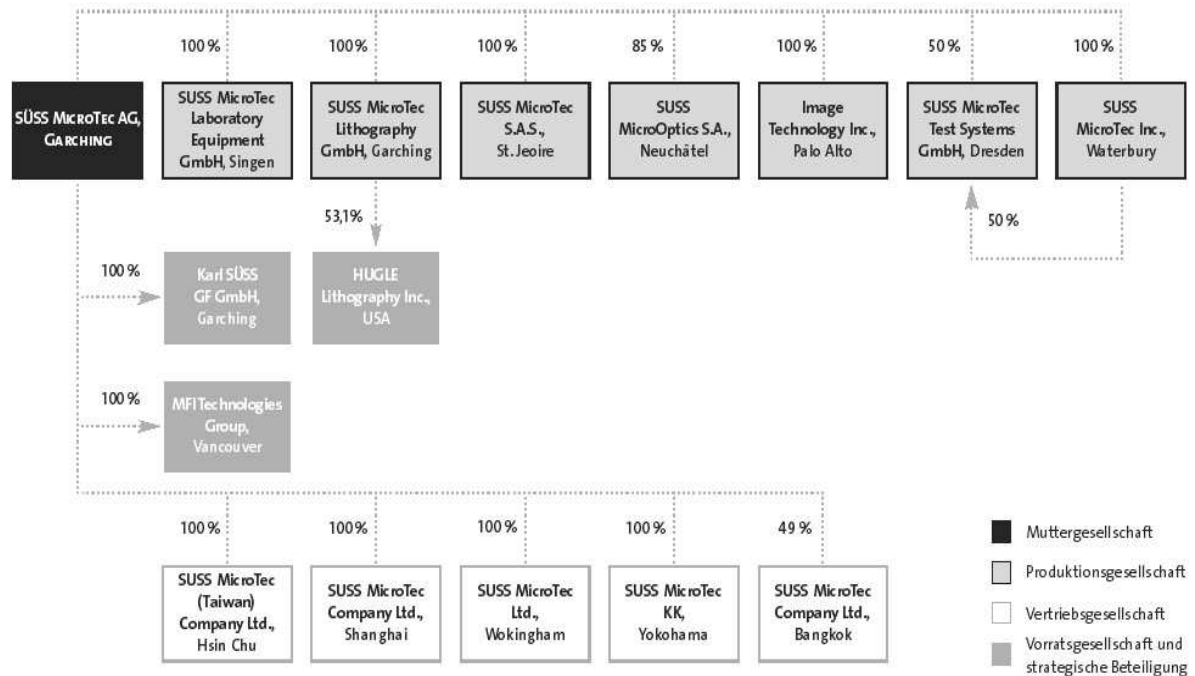
Konzernholding

Segment Lithografie	Segment Substrat Bonder	Segment Device Bonder	Segment Test Systeme	Segment Sonstige
				Masken
				Mikrooptik
				C4NP
				Konzernholding

Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der Muttergesellschaft, der Süss MicroTec AG, als Management- und Finanzierungsholding, sowie den in der Regel mehrheitlich in Besitz der Muttergesellschaft stehenden Tochtergesellschaften. In den Tochtergesellschaften sind jeweils Entwicklungs- und Produktionstätigkeiten oder auch lokale Vertriebstätigkeiten für den Konzern organisiert. Die Gruppe verfügt über Standorte unter anderem in Deutschland, den USA, Frankreich, China und Taiwan.

## Rechtliche Struktur des Konzerns:

### Rechtliche Struktur des Konzerns:



Geringfügige Beteiligungen: ZTS Glaubitz (10%)  
 Electron Mec S.r.L, Milano (10%)  
 Holtronic Techn. S.A. Marin, Helvetia (10%)

Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt insbesondere bei Leitungsfunktionen durch die Aufteilung in fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die variablen Gehaltsbestandteile orientieren sich in der Regel an der Erreichung persönlicher und finanzieller Ziele, die jeweils jährlich neu festgelegt werden. Ein bestimmter Kreis von Mitarbeitern nimmt zudem am Aktienoptionsplan des Konzerns teil.

Die Bezüge des Vorstandes enthalten ebenfalls fixe und variable Bestandteile. Als fixe Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder monatliche Gehaltszahlungen, Zuschüsse zur Sozialversicherung sowie einen Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit.

Als kurzfristige variable Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder einen Jahresbonus, der sich an individuell festgelegten Zielen orientiert. Eine nachträgliche Änderung der definierten Ziele ist ausgeschlossen.

Die Bezüge bestehen zudem aus einer variablen Vergütungskomponente mit langfristiger, renditeorientierter Anreizwirkung in Form eines Aktienoptionsplans.

## 2. Unternehmenssteuerung, Ziele und Strategie

Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere am Auftragseingang, Umsatz und dem Auftragsbestand der einzelnen Segmente. Die Performance der Segmente wird dabei vor allem durch Beobachtung der Entwicklung der Rohertragsmarge (Umsatz abzüglich der Herstellkosten) sowie des Net Operating Profit gemessen. Der Net Operating Profit eines Segmentes stellt innerhalb des Konzerns den Rohertrag abzüglich der zugeordneten Kos-

ten für Verwaltung, Vertrieb, Forschung und Entwicklung sowie sonstige zuordenbare Kosten und Erträge dar.

Weitere Steuerungskennzahl ist die Net Cash – Position (Flüssige Mittel abzüglich Finanzschulden), die eine wesentliche Steuerungsgröße für die Finanzierungsfunktion der Holding darstellt.

Die Steuerungskennzahlen haben sich teilweise deutlich verändert, da die Konzernrechnungslegung mit Abschluss des Geschäftsjahres 2005 von US-GAAP auf IFRS umgestellt wurde. Aus diesem Grund ergeben sich bei wesentlichen Bilanz- und Ergebniskennzahlen Veränderungen im Vergleich zu früheren Veröffentlichungen. Die Umstellung beinhaltet auch das Vorjahr 2004, so dass die Vergleichszahlen unter Zugrundelegung gleicher Prämissen erstellt wurden. In der Konsequenz werden somit die nachstehend genannten Vorjahreszahlen ebenfalls nicht mit den Werten des Geschäftsberichtes 2004 oder den Werten für 2004 in den Berichten zu den ersten drei Quartalen 2005 identisch sein. Nähere Angaben hierzu entnehmen Sie bitte dem Anhang zum Konzernabschluss.

SÜSS MicroTec verfolgt die Besetzung lukrativer Nischen in der Industrie der Halbleiterausrüster als Strategie. Wir wollen durch eine klare Positionierung stets innerhalb der Top 3-Anbieter in den relevanten Märkten agieren. Partnerschaften mit führenden Instituten und Unternehmen der Industrie sollen sicherstellen, dass wesentliche Trends oder zukunfts-trächtige Technologien stets rechtzeitig erkannt und auf deren Potenziale für SÜSS MicroTec überprüft werden. Im Vordergrund steht dabei organisches Wachstum; nur im Falle interessanter Technologien oder sinnvoller Komplementärprodukte wird auch externes Wachstum in Betracht gezogen.

### **3. Forschung und Entwicklung**

Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sind von essenzieller Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit sowohl der bestehenden als auch zukünftiger Produkte. Sie stellen für unser Unternehmen Investitionen in die Zukunft dar.

Unsere Branche ist, obwohl vieles auf die Entwicklung zu einer reiferen Industrie deutet, nach wie vor sehr F&E-intensiv. Auf der einen Seite erzwingen neue Endprodukte mit sehr hohen Wachstumsraten – wie zum Beispiel Leuchtdioden (LED) - neue Maschinentypen. Auf der anderen Seite nimmt der Wettbewerb um die Kostenführerschaft unter unseren Kunden zu. Dieser Wettbewerb führt dann auch zu einem Preisdruck bei den von uns zu liefernden Maschinen. Wer als Maschinenlieferant in diesem Umfeld bestehen will, muss seinen Kunden die „produktivere“ Maschine anbieten können, nicht zwangsläufig die „billigere“: Hohe Qualität, Zuverlässigkeit – in der Branche durch den Begriff „machine uptime“ beschrieben - und hoher Durchsatz sind wichtig für unsere produzierenden Kunden.

Im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt unserer F&E-Tätigkeit klar bei der Entwicklung der Tools für die C4NP-Produktionslinie. Hierzu wurde die Entwicklung der einzelnen Tools auf diejenigen Standorte verteilt, die in ihrer jeweiligen Kernkompetenz den einzelnen Entwicklungszielen am nächsten waren. Durch diese Parallelisierung konnte die Entwicklungszeit bis zu einem marktreifen Produkt („time-to-market“) für die C4NP-Pilotlinie entscheidend verkürzt werden. Im zweiten Schritt erfolgt nun die Integration der einzelnen Tools zu einer C4NP-Produktionslinie in unserem Standort in Waterbury, Vermont in den USA. Dort wurde für dieses bedeutende Vorhaben eine eigene Entwicklungsabteilung mit hoher eigener Entscheidungskompetenz geschaffen.

Daneben haben wir vorrangig Entwicklungen betrieben, die der mittel- und langfristigen Sicherung der Margen dienen. Dazu wurden besondere Anstrengungen bei der Standardisierung und Modularisierung unserer Produkte unternommen: Nach einem grundlegenden internen Assessment der in unseren Maschinen verwendeten Steuerungskonzepte wurde

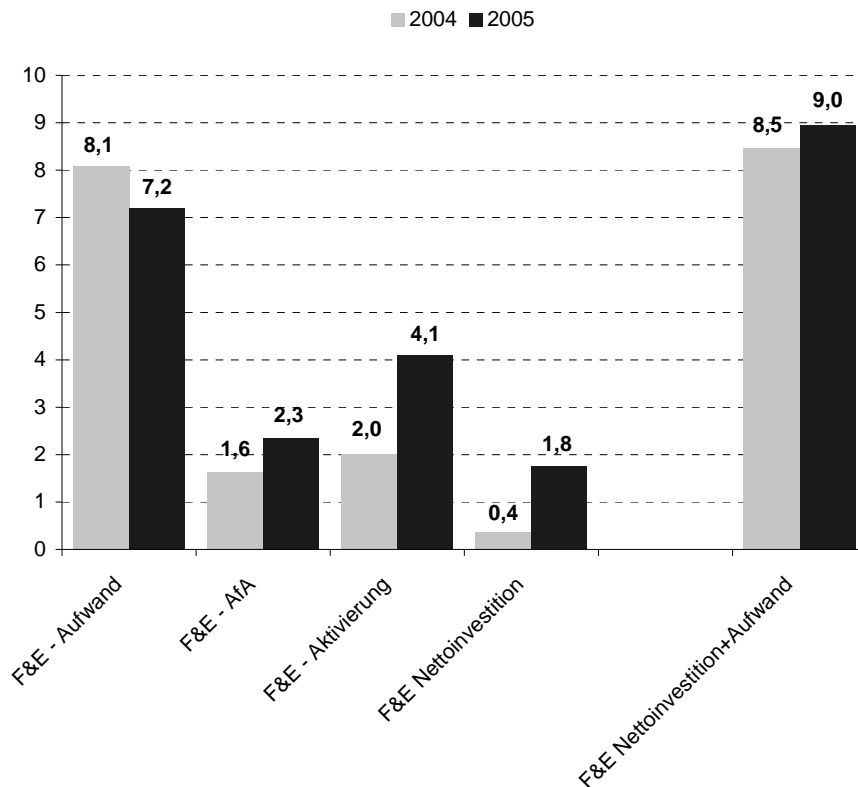
ein neues System entwickelt, das als Basis für die kommenden Maschinengenerationen dienen soll. Neben einer klassischen PLC-Steuerung auf Maschinenebene wurde ein „intelligenter“ Überbau auf PC-Ebene programmiert, der die komplexen Funktionen wie Rezeptierung von Prozessen, Robot Vision und Kommunikation im Netzwerk kontrolliert. Somit wurden die Eigenschaften „höchste Zuverlässigkeit“ und „uneingeschränkte Flexibilität“ in eine gute Synthese gebracht.

Im Zusammenhang mit diesem Projekt wurde durch die Einführung des Produktions-Mask Aligners MA200 compact das gesamte, in Jahrzehnten erlernte Know-how unseres Segmentes Lithografie in eine moderne Produktfamilie verdichtet. Diese zeichnet sich nun durch einen modularen Aufbau, die Verwirklichung des neuen, standardisierten Steuerungskonzepts und die daraus resultierende hohe Produktivität aus. Diese modulare Produktfamilie ersetzt die bisherige Variantenvielfalt, ohne Lücken im Angebot entstehen zu lassen.

Ähnliche Arbeiten wurden für die Bond Cluster durchgeführt, mit denen wir bei den Herstellern immer erfolgreicher werden. Für den stark wachsenden Markt Leuchtdioden (LED) wurde zusätzlich eine neue Variante des Substrat Bonders bereitgestellt. Die für die Herstellung von LEDs benötigten Wafer basieren nicht auf Material aus nur einem chemischen Element – dem hochreinem Silizium - sondern auf sogenannten Verbindungshalbleitern von Typ III-V oder II-VI. Beispiele dafür reichen von GalliumArsenid (GaAs) oder IndiumPhosphid (InP) bis hin zu vier chemischen Elementen wie zum Beispiel InGaAsP als einem sogenannten quaternären Halbleiter. Diese Wafer sind sehr teuer und können nur in kleinen Durchmessern gefertigt werden, typischerweise bis 2“ (51 mm). Werden diese kleinen Wafer in Substrat Bondern verarbeitet, so ist es wünschenswert, bei jeder Beladung des Bonders gleich mehrere dieser kleinen Wafer zu prozessieren. Der von uns entwickelte neue LED-Multibonder erlaubt es, acht Wafer mit 2“ Durchmesser in einem Arbeitsgang zu prozessieren. Dies ist für die LED-Hersteller, die aufgrund ihrer hohen Stückzahlen an einem hohen Durchsatz interessiert sind, ein großer Vorteil bei der Produktivität.

Schließlich arbeiten wir weiterhin auch an mehreren Projekten im Bereich Nanotechnologie. Für die Zukunftstechnologie „Nanoimprinting“ konnten wir bereits den aus der Device Bonding Technology abgeleiteten Nanostepper NPS300 weitgehend fertig stellen. Dieses Projekt wurde und wird immer noch über EU-Fördermittel nachhaltig unterstützt: So konnten wir bei überschaubarer eigener Investition bereits zwei international renommierten Forschungseinrichtungen Maschinen für die Entwicklung künftiger Fertigungsprozesse zur Verfügung stellen. Das wird uns ermöglichen, an einem Innovationsmarkt zu partizipieren, wenn die neuen Technologien in nicht allzu ferner Zukunft Eingang in die Produktion von Halbleiter- und Nanosystemprodukten finden.

## F&E – Ausgaben im Jahresvergleich in Mio. EUR



Die gesamten Ausgaben für Forschung und Entwicklung blieben im Jahresvergleich nahezu unverändert. Der deutliche Anstieg der Aktivierung von Entwicklungsleistungen ist größtenteils auf das Projekt C4NP zurückzuführen. Aufgrund des höheren Umsatzes in 2005 blieb die Quote (in Prozent vom Umsatz) unverändert bei 7,6%.

Die Mitarbeiterzahl im Bereich F&E und Prototyping belief sich zum Jahresende 2005 auf 112 Personen (+8,7% gegenüber 2004). Unsere Absicht ist, nicht nur diese für unsere Zukunft so entscheidende Mitarbeitergruppe zu stärken, sondern zusätzlich auch in die Applikations- und Prozessentwicklung zu investieren.

### 4. Überblick über den Geschäftsverlauf

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2005 befand sich die Weltwirtschaft weiterhin auf einem stabilen Wachstumspfad. Sie wuchs um rund 4%, getrieben vor allem durch die weiterhin positive Entwicklung in Asien. Aufgrund dieser Daten gehen wir davon aus, dass sich das Konsumklima im Vergleich zu 2004 nicht wesentlich geändert hat.

Die für uns relevanten Märkte entwickelten sich unterschiedlich. So stieg der weltweite Umsatz mit Halbleitern im Vergleich zum Vorjahr um rund 8%. Die Industrie der Halbleiter-Ausrüster jedoch musste einen Umsatzrückgang von 11% (Quelle: SEMI) verzeichnen. Die Umsatzentwicklung unseres Unternehmens zeigte in 2005 erneut, dass SÜSS nicht direkt von den Zyklen der Halbleiter-Ausrüster-Industrie abhängt.

So waren nach den ersten neun Monaten des Jahres 2005 sowohl der kumulierte Umsatz als auch der Auftragseingang jeweils unterhalb der Vorjahreswerte. Erst ein außerordentlich starkes viertes Quartal, in dem sowohl die Auslieferungen als auch die Auftragseingänge deutliche Steigerungsraten aufwiesen, führte letztlich zu jeweils höheren Werten im Gesamtjahresvergleich.

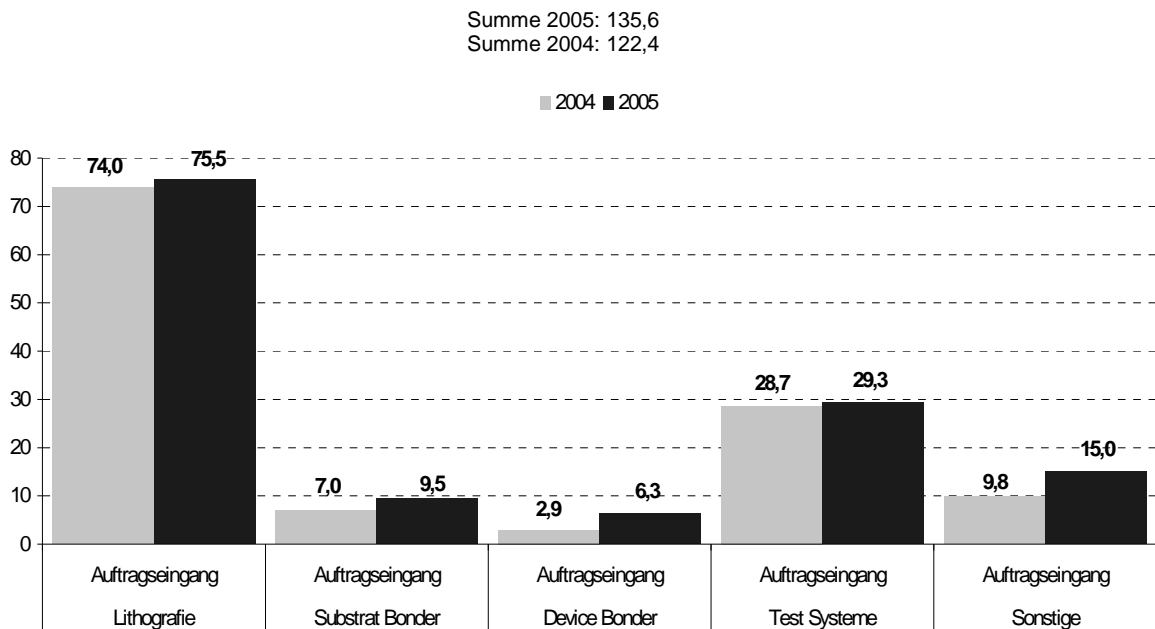
Hinsichtlich der Währungsentwicklung sind die Effekte auf Umsatz und Auftragseingang vernachlässigbar. Der hier verwendete Durchschnittskurs veränderte sich nur geringfügig. Jedoch ergaben sich aufgrund des deutlich stärkeren US-Dollar zum Bilanzstichtag (1,18 USD / 1,00 EUR zum 31.12.2005 gegenüber 1,36 zum 31.12.2004) spürbare Buchgewinne.

• **Umsätze und Auftragslage der Segmente**

Der bereits in 2004 begonnene positive Trend bei Auftragseingang und Umsatz wurde somit auf Gesamtjahressicht fortgesetzt. Für den hohen Auftragseingang im vierten Quartal 2005 waren unter anderem folgende Einzelaufträge bzw. Marktbesonderheiten, die erwartungsgemäß nicht permanent und nachhaltig wiederkehren, verantwortlich:

- Großauftrag für Advanced Packaging 5,7 Mio. EUR
- Ersatzinvestition Großkunde 3,2 Mio. EUR
- Device Bonder 3,2 Mio. EUR
- Großaufträge für Substrat Bonder 3,3 Mio. EUR

Auftragseingang nach Segmenten in Mio. EUR

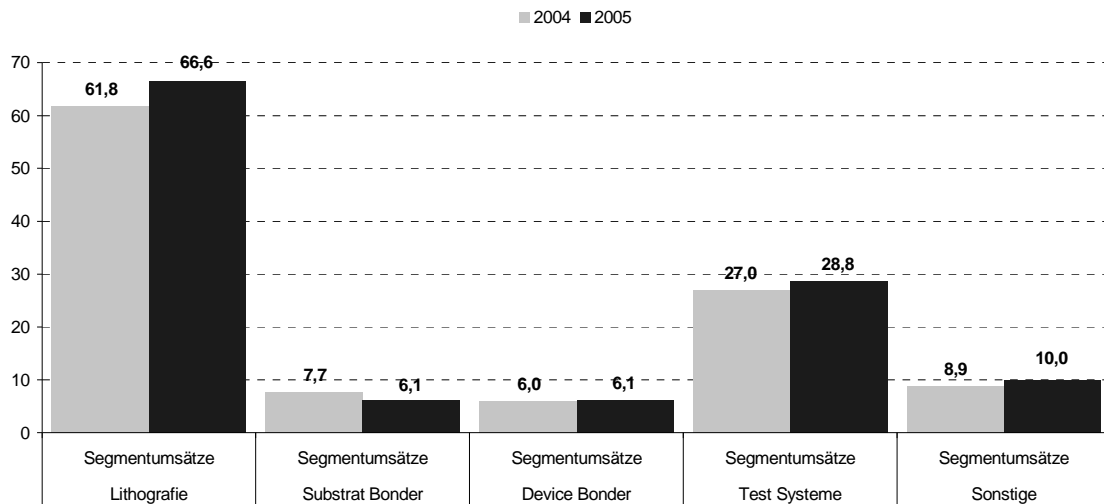


Zusammenfassend waren für das Wachstum beim Auftragseingang von 122,4 Mio. EUR auf 135,6 Mio. EUR (+10,8%) auf Gesamtjahressicht vor allem C4NP (enthalten im Segment „Sonstige“) sowie die Erholung bei den Segmenten Substrat Bonder und Device Bonder verantwortlich. Die Entwicklung innerhalb der Segmente wird an anderer Stelle näher erläutert.



## Umsätze nach Segmenten in Mio. EUR

Summe 2005: 117,5  
Summe 2004: 111,3



Die Steigerung der Umsätze im Segment Lithografie beruht im Wesentlichen auf den Zuwächsen bei den Coatern, wobei sich hier insbesondere die Produktlinie der halbautomatischen Spin Coater (Produktlinie „Gamma“) seit nunmehr zwei Jahren als sehr wettbewerbsfähig darstellt. Bei den anderen Segmenten entwickelten sich die Umsätze annähernd wie im Vorjahr, was auf eine relativ unveränderte Investitionsbereitschaft innerhalb unserer Märkte im abgelaufenen Geschäftsjahr hindeutet.

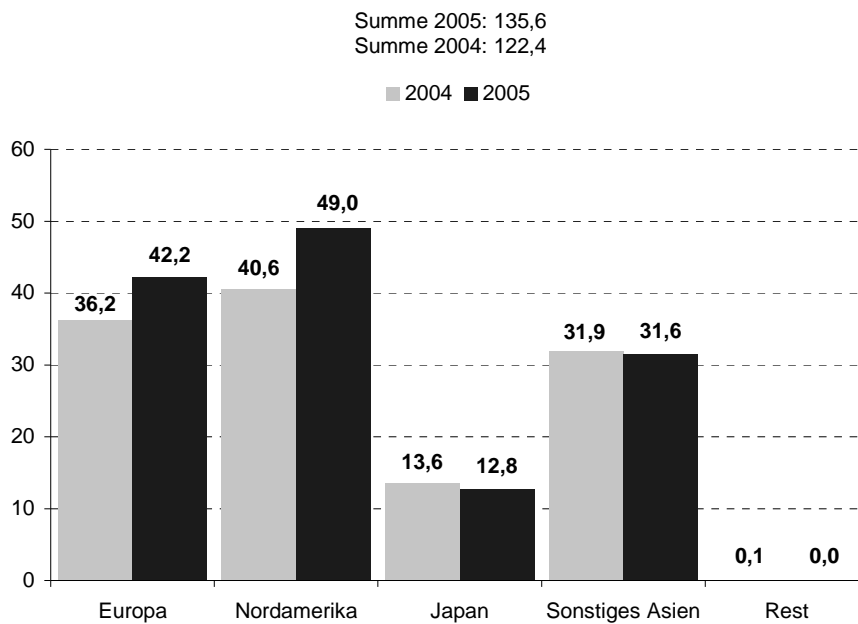
### • Umsätze und Auftragslage in den Regionen

Bei der Betrachtung der Regionen gab es Verschiebungen. Europa und Nordamerika entwickelten sich im Jahresverlauf positiv, während Asien und Japan insbesondere beim Umsatz hinter dem Vorjahr zurück blieben. Typischerweise sind die Märkte schwerpunktmäßig in folgenden Regionen vertreten:

- Mikrosystemtechnik und Verbindungshalbleiter: Europa, Nordamerika und Japan
- Test Systeme: Europa und Nordamerika
- Advanced Packaging: Sonstiges Asien

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass mit regionalen Verschiebungen bei der Entwicklung von Auftragseingang und Umsatz nicht zwingend eine Verschiebung innerhalb unserer Zielmärkte verbunden ist. Das hängt damit zusammen, dass global agierende Kunden in allen Regionen Fabriken installiert haben. Daher zeigen Änderungen in der regionalen Verteilung nur auf, wo die Investitionen stattfanden. Wir gehen davon aus, dass sich innerhalb der adressierten Märkte insgesamt keine wesentliche Änderung im Vergleich zum Vorjahr eingestellt hat.

## Entwicklung der Auftragseingänge nach Regionen in Mio. EUR

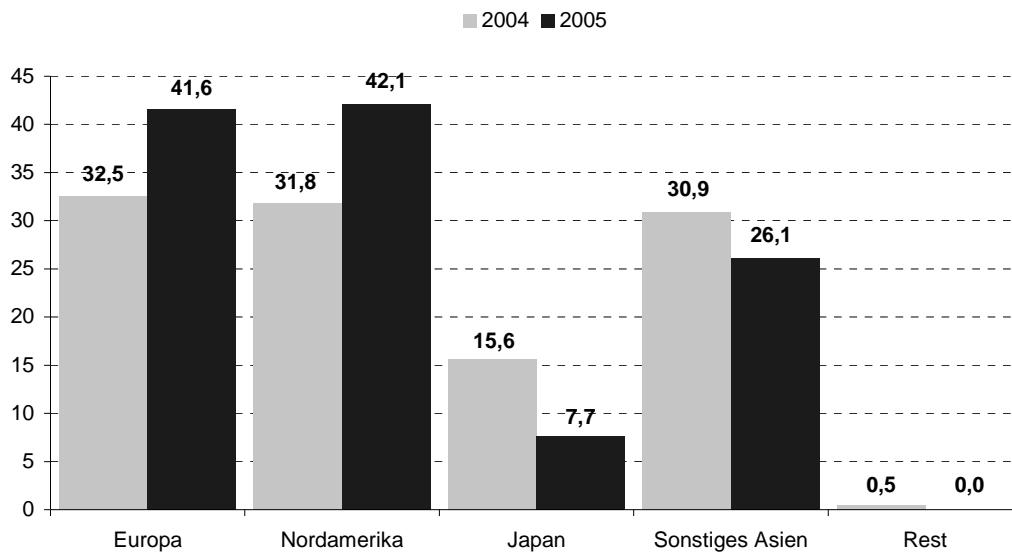


Bei der Umsatzentwicklung gab es dagegen signifikante Verschiebungen innerhalb der Regionen. In Europa und Nordamerika konnten die Umsätze im Jahresvergleich deutlich gesteigert werden. In Asien (ohne Japan) blieb der Umsatz im Jahresvergleich zurück. Dies führen wir auf die Fokussierung auf Produktionsmaschinen in dieser Region zurück, die höhere Volatilitäten erzeugt. Denn während in den anderen Regionen die kleineren und manuellen Systeme einen permanenten und laufenden Umsatzbeitrag liefern, ist dies in dieser Region nur zu kleineren Teilen der Fall. Im Jahr 2005 wurden auch in dieser Region mehrere Aufträge erst zum Ende des Jahres akquiriert bzw. Maschinen erst spät im Jahr geliefert, und wurden somit aufgrund fehlender Abnahme durch den Kunden nicht mehr umsatzwirksam.

In Japan ging der Umsatz um mehr als die Hälfte zurück. Dies hing einerseits damit zusammen, dass zum Jahresende 2004 das Auftragsbuch relativ stark ausgekehrt wurde. Andererseits wurde mehr als ein Drittel des Auftragseingangs 2005 in Japan erst im vierten Quartal realisiert. Wir gehen nicht von einer Änderung bzw. Verschlechterung des Markt- und Konkurrenzumfeldes für unser Unternehmen in Japan aus, da der Auftragseingang nur unwesentlich unterhalb des Vorjahreswertes blieb.

## Entwicklung der Umsätze in den Regionen in Mio. EUR

Summe 2005: 117,5  
Summe 2004: 111,3

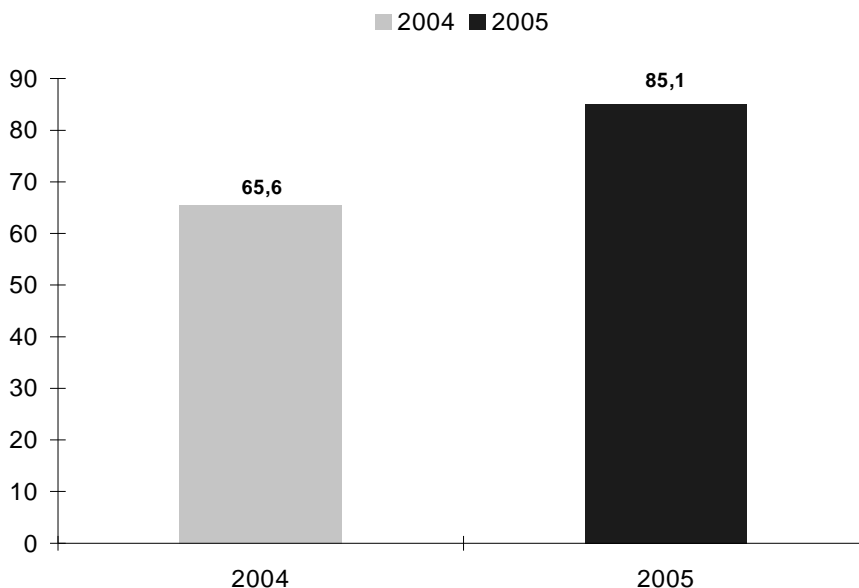


- **Auftragsbestand in der Gruppe**

Das Verhältnis zwischen neu eingegangenen Aufträgen und realisierten Umsätzen, die sogenannte Book-to-bill Ratio, lag 2005 bei 1,15 (2004: 1,10). Wesentlicher Sondereffekt in 2004 war eine Wertberichtigung in Höhe von 4,3 Mio. EUR (brutto) für eine Position, bei der wir nicht von einer Lieferung in 2005 oder 2006 ausgehen.

Der Auftragsbestand enthält üblicherweise Aufträge, die in den kommenden 5 bis 9 Monaten umsatzwirksam werden. Diese Zeitspanne beinhaltet neben der reinen Produktionszeit (in der Regel bis zu 6 Monate) auch den Abnahmeprozess (in der Regel bis zu 3 Monate nach Lieferung).

## Auftragsbestand in der Gruppe in Mio. EUR



Der Auftragsbestand zum Jahresende 2005 lag um 30% über dem Vorjahreswert. Die Zuwächse betrafen vor allem die Regionen Nordamerika und Japan.

Im Auftragsbestand per Ende 2005 sind Aufträge in Höhe von 8,1 Mio. EUR enthalten, bei denen wir nicht von einer Umsatzrealisierung im Geschäftsjahr 2006 ausgehen. Da jedoch eine Lieferung in diesem Jahr geplant ist, verbleiben diese Positionen im Auftragsbestand.

### **Geschäftsentwicklung in den einzelnen Segmenten:**

- **Lithografie**

Das Segment Lithografie beinhaltet Entwicklung, Produktion und Vertrieb der Produktlinien Mask Aligner und Coater, und ist in Deutschland, vor allem an den Standorten Garching bei München und Vaihingen bei Stuttgart, angesiedelt. Darüber hinaus sind wichtige Teile der Vertriebsorganisationen in Nordamerika und Asien für dieses Segment tätig. Die Lithografie stellt deutlich mehr als die Hälfte des Gesamtgeschäftes der Gruppe dar und ist den Märkten Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter und Advanced Packaging stark vertreten.

Im abgelaufenen Jahr konnten sich erfreulicherweise die wichtigsten Indikatoren dieses Segments im Jahresvergleich verbessern. Verantwortlich für diese positive Entwicklung war insbesondere die weiterhin gute Geschäftslage bei den Coatern. Denn bei den Mask Alignern befand sich die Entwicklung auch in 2005 noch unter dem Einfluss der Restrukturierung, im Rahmen derer Mitte des Jahres das Werk Aßlar geschlossen wurde. Die dort ansässige Produktion, vor allem manueller Mask Aligner, wurde in das Werk Garching bei München integriert. Dabei wurden 39 Mitarbeiter abgebaut. Im Gegenzug wurden in den einzelnen Regionen die technische Kompetenz und die Servicekapazität ausgebaut.

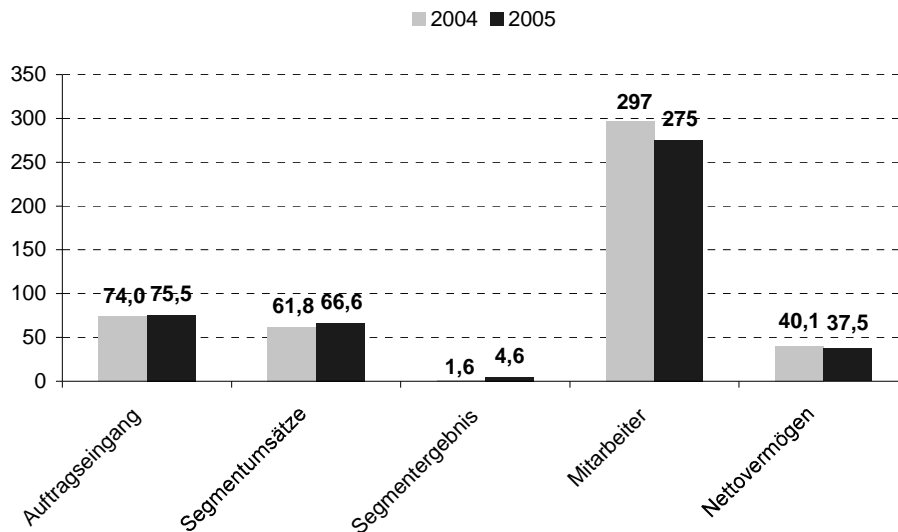
Die Auftragseingänge für Mask Aligner entwickelten sich in den ersten 9 Monaten sehr schleppend: Aufträge für neue Maschinen lagen kumuliert um bis zu 40% unter den Vorjahreswerten. Im vierten Quartal stellte sich jedoch eine positive Entwicklung ein, so dass Aufträge für neue Maschinen letztlich nur noch rund 12% (30,1 Mio. EUR in 2005 gegenüber 34,3 Mio. EUR in 2004) unterhalb des Vorjahreswertes lagen. Etwas besser stellte sich die Umsatzentwicklung dar (27,2 Mio. EUR in 2005 gegenüber 28,8 Mio. EUR in 2004; -5%).

Bei den Coatern setzte sich der positive Trend aus 2004 auch in 2005 fort. Die halbautomatische „Gamma“-Produktlinie erfreute sich weiterhin großer Beliebtheit. Das Produkt findet nicht nur Anklang bei den asiatischen Auftragsfertigern, sondern auch bei den Chipherstellern in der Mikrosystemtechnik und bei den Verbindungshalbleitern. Insgesamt zeigte sich die Nachfrage nach automatischen Geräten relativ stabil. Sie werden vor allem für 8-Zoll-Wafer in der Produktion von Mikrosystemen und im Advanced Packaging (hier 8- und 12-Zoll-Wafer) eingesetzt. Die manuellen Geräte finden insbesondere in universitären und betrieblichen Forschungseinrichtungen Anwendung; sie werden aber auch bei kleineren Produktionsanwendungen bei Verbindungshalbleitern und in der Mikrosystemtechnik eingesetzt.

Der Auftragseingang für Coater konnte nochmals deutlich um über 20%, von 27,6 Mio. EUR (2004) auf 33,2 Mio. EUR, gesteigert werden. Ein ähnliches Bild zeigte sich beim Umsatz. Er stieg auf 27,9 Mio. EUR in 2005 gegenüber 23,0 Mio. EUR in 2004 (+21%).

Unter Berücksichtigung von Service und Ersatzteilen ergab sich für das Segment Lithografie ein Auftragseingang in Höhe von insgesamt 75,5 Mio. EUR (Vorjahr: 74,0 Mio. EUR; +2%). Der Segmentumsatz betrug insgesamt 66,6 Mio. EUR (Vorjahr: 61,8 Mio. EUR; +8%).

## Segmentübersicht Lithografie (in Mio. EUR bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt)



Das Segmentergebnis verbesserte sich von 1,6 Mio. EUR auf 4,6 Mio. EUR (+3,0 Mio. EUR), wobei dies hauptsächlich auf einen von 26,6 Mio. EUR auf 29,4 Mio. EUR (+2,8 Mio. EUR) gesteigerten Rohertrag zurückzuführen ist. Die Rohertragsmarge stieg von 43,0% auf 44,2%. Besondere Ergebnisbelastungen in 2005 stellten die Beratungskosten für die Restrukturierung (rund 2,0 Mio. EUR) sowie negative Ergebniseffekte in Verbindung mit dem Verkauf der Immobilie in Aßlar (0,5 Mio. EUR außerplanmäßige Abschreibung) dar.

Der Rückgang des Segmentvermögens (netto) von 40,1 Mio. EUR in 2004 auf 37,5 Mio. EUR in 2005 (- 7%) ist bezüglich des Umlaufvermögens vor allem auf die erfolgreiche Verringerung des Lagerbestandes um 2,2 Mio. EUR (-7%) zurückzuführen. Darüber hinaus war neben den Abschreibungen auf aktivierte F&E – Leistungen insbesondere der Abgang der Immobilie Aßlar für den Rückgang des Anlagevermögens um 14% verantwortlich. Hinsichtlich rückläufiger Verbindlichkeiten sind die verringerten Kundenanzahlungen (17,6 Mio. EUR gegenüber 22,3 Mio. EUR im Vorjahr; -21%) erwähnenswert.

### • Substrat Bonder

Das Segment Substrat Bonder ist hinsichtlich Entwicklung und Produktion am Standort Waterbury, Vermont, in den USA angesiedelt. Der Vertrieb ist über Waterbury hinaus in kleinen Einheiten an wesentlichen Standorten in Europa und in Asien ansässig.

In den letzten zwei Jahren wurde das komplette Portfolio durch neu entwickelte Maschinen ersetzt. Die Durchdringung des Marktes mit diesen Systemen hat unverändert oberste Priorität, wobei wir überzeugt sind, in 2005 einen weiteren Schritt in diese Richtung getan zu haben.

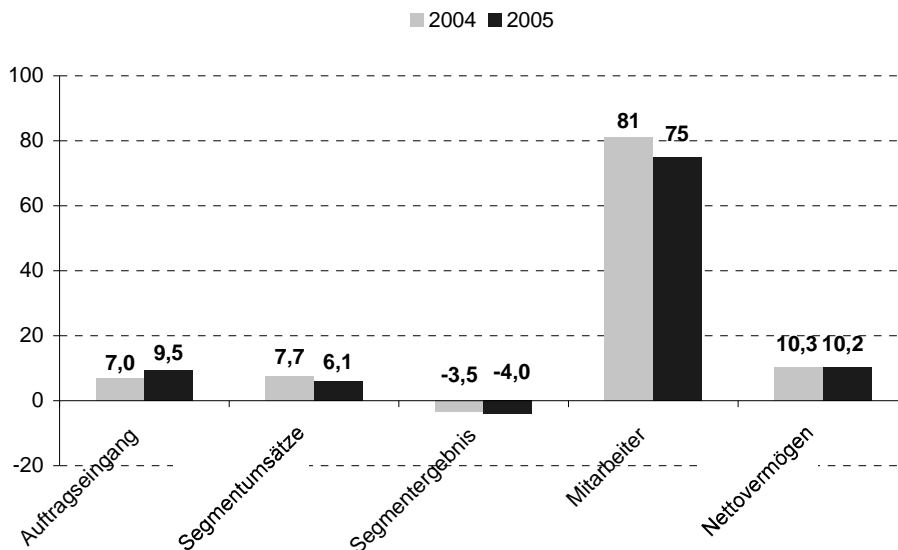
Insbesondere der sogenannte Bond Cluster, der vakuumfreies Bonden ermöglicht, stellt ein wichtiges Standbein für dieses Segment dar. Daneben werden vor allem manuelle Maschinen für 6- und 8-Zoll-Wafer-Anwendungen angeboten. Aufgrund der hohen Stückpreise der Bond Cluster prägt deren Entwicklung wesentlich den Geschäftsverlauf dieses Segments.

In 2005 konnte die Position der manuellen Geräte am Markt verbessert werden. Insbesondere in Nordamerika und in Asien stieg der Auftragseingang spürbar an. Die Nachfrage nach den Bond Clustern verbesserte sich leicht im Jahresvergleich. Die Anwendungen insbesondere des Wafer Bondings werden in der Zukunft weiter zunehmen - nicht zuletzt auf-

grund der steigenden Bedeutung des „Chip-Stackings“ und des sogenannten „SOI-Bondings“ (Silicon-on-Insulator).

Jedoch lag der Umsatz aufgrund des hecklastigen Auftragseingangs, d.h. hohe Auftragseingänge erst zum Ende des Jahres, unterhalb des Vorjahreswertes. Es ergab sich ein Auftragseingang für das Segment in Höhe von 9,5 Mio. EUR (Vorjahr: 7,0 Mio. EUR; +36%). Der Segmentumsatz betrug 6,1 Mio. EUR (Vorjahr: 7,7 Mio. EUR; -21%).

Segmentübersicht Substrat Bonder (in Mio. EUR bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt)



Das negative Segmentergebnis erhöhte sich von – 3,5 Mio. EUR im Vorjahr auf – 4,0 Mio. EUR, wobei der Rohertrag mit 0,6 Mio. EUR um 36% unter dem Vorjahr lag. Die Rohertragsmarge bei dieser Produktlinie ist derzeit mit 10,1% (Vorjahr: 12,5%) noch sehr niedrig. Dies ist sowohl bedingt durch eine noch nicht ausreichende Auslastung des Werkes in Waterbury, als auch noch nicht sichtbare positive Lernkurveneffekte. Die F&E-Aufwendungen wurden im Jahresvergleich nochmals deutlich von 1,0 Mio. EUR auf 1,8 Mio. EUR erhöht, um so schnell wie möglich eine ausreichende Produktreife zu erreichen. Wir gehen davon aus, dass sich ab 2006 eine spürbare Verbesserung der Marge einstellt.

Das Segmentvermögen (netto) änderte sich nur unwesentlich. Den um 1,7 Mio. EUR erhöhten Lagerbeständen standen um 1,5 Mio. EUR erhöhte Kundenanzahlungen gegenüber.

- **Device Bonder**

Das Segment Device Bonder ist in St. Jeoire, Frankreich, ansässig. An diesem Standort befinden sich neben der Entwicklung und Produktion auch wesentliche Teile der Vertriebsorganisation. Aufgrund der technischen Komplexität und der geringen Größe des Marktes sind keine weiteren wesentlichen Vertriebsorganisationen innerhalb des Konzerns für dieses Segment tätig.

Das Geschäftsumfeld für Device Bonder bleibt unverändert schwierig und schwer einschätzbar. Nach dem sehr schwachen Jahr 2004 entwickelte sich die Produktlinie auch in den ersten neun Monaten des Jahres 2005 negativ, und blieb beim Auftragseingang sogar

noch unter den Werten des Jahres 2004. Einen Großteil des Auftragsvolumens 2005 realisierten wir erst im vierten Quartal.

Prinzipiell ist das Produkt mit den Eigenschaften „hochgenau und geringer Durchsatz“ in einem sehr engen Markt platziert. In den Jahren 2000 und 2001 erlebte die Produktlinie einen Boom im Bereich optische Netzwerke, der jedoch 2002 abrupt endete. Seit dieser Zeit konnte sich kein ausreichend großer, neuer adressierbarer Markt entwickeln.

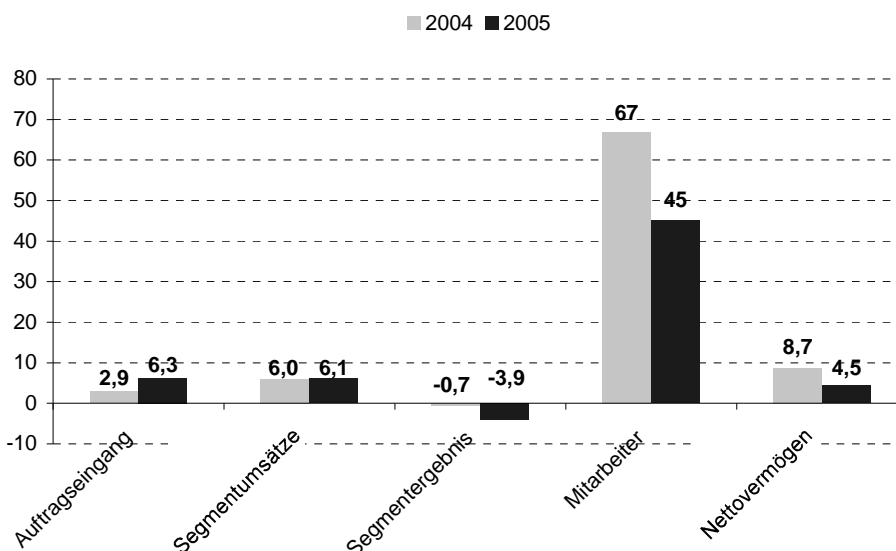
Als Konsequenz musste die Anzahl der Mitarbeiter im abgelaufenen Jahr nochmals drastisch von 66 auf 37 reduziert werden. Dadurch konnte die Kostenbasis soweit abgesenkt werden, dass das Segment in 2006 zumindest ein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaften sollte.

Im Laufe des Jahres 2005 wurden mehrere Überlegungen angestrengt, wie zukünftig mit der Produktlinie verfahren werden sollte. Dies wurde auch bereits im Lagebericht zum Geschäftsjahr 2004 angekündigt. Erfreulicherweise stellte sich im vierten Quartal 2005 beim Auftragseingang eine spürbare Belebung ein, die vor allem auf Anwendungen in der Infrarot-Sensorik basierte. Mehrere Aufträge konnten in Asien akquiriert werden.

Die derzeit unzureichende langfristige Perspektive führte zu entsprechenden Wertberichtigungen im abgelaufenen Geschäftsjahr. Ob der verbesserte Auftragseingang im vierten Quartal 2005 nachhaltiger Natur ist, wird sich aber erst im laufenden Jahr herausstellen.

Es ergab sich ein Auftragseingang für das Segment in Höhe von 6,3 Mio. EUR (Vorjahr: 2,9 Mio. EUR; +114%). Der Segmentumsatz betrug 6,1 Mio. EUR (Vorjahr: 6,0 Mio. EUR; +2%).

Segmentübersicht Device Bonder (in Mio. EUR bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt)



Das Segmentergebnis belief sich auf –3,9 Mio. EUR (Vorjahr: -0,7 Mio. EUR). Dabei prägten vor allem folgende außerordentliche Wertberichtigungen diese Verluste:

- Vollabwertung des zugeordneten  
Geschäfts- oder Firmenwertes - 1,8 Mio. EUR
- Teilabwertung der Immobilie St. Jeoire - 1,1 Mio. EUR
- Teilabwertung des Lagerbestandes - 0,8 Mio. EUR

Die Rohertragsmarge verringerte sich von 64,0% im Vorjahr auf 32,5%. Die hohe Marge in 2004 war vor allem durch teilweisen Abverkauf von bereits wertberichtigten Beständen erheblich positiv begünstigt.

Der deutliche Rückgang des Segmentvermögens (netto) um 48% ist auf Wertberichtigungen bei den kurz- und langfristigen Vermögenswerten zurückzuführen.

Darüber hinaus wurden rückläufige Forderungsbestände (- 1,4 Mio. EUR) durch rückläufige Kundenanzahlungen (-1,3 Mio. EUR) im Wesentlichen kompensiert.

- **Test Systeme**

Dieses Segment stellt rund ein Viertel des Geschäftsvolumens der Gruppe dar und ist in Sacka bei Dresden beheimatet. Entwicklung, Produktion sowie der Vertrieb in Europa sind hauptsächlich dort angesiedelt. In den internationalen Vertriebsorganisationen (Nordamerika, Asien) arbeiten nach der Lithografie die meisten Mitarbeiter für dieses Segment.

Die Test Systeme zeichnen sich vor allem durch eine weniger zyklische Geschäftsentwicklung aus. Auch die Entwicklung im Jahr 2005 war typisch für dieses Segment: Moderates, aber nachhaltiges Wachstum bei positivem Segmentergebnis.

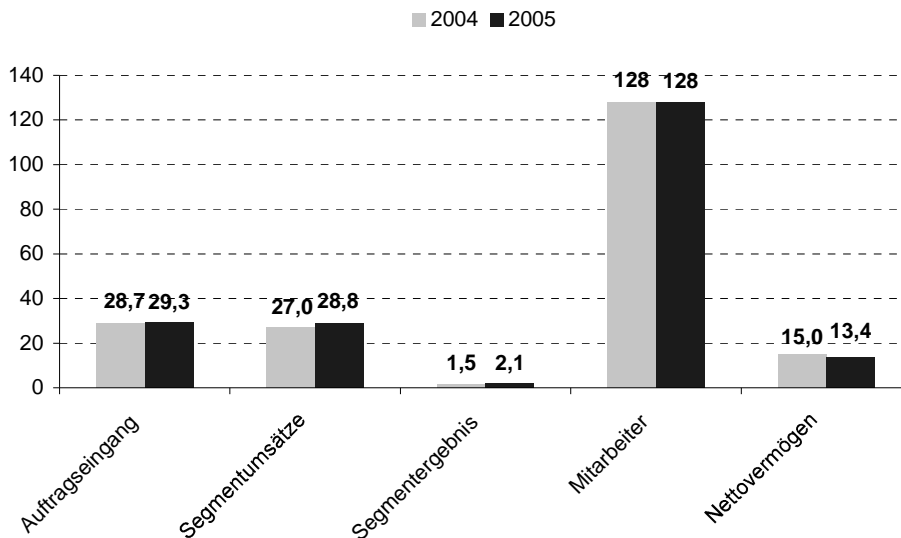
Mit unseren Probern adressieren wir hauptsächlich Laboranwendungen, insbesondere z.B. die Fehleranalyse, aber auch teilweise Anwendungen im Produktionsumfeld (Mikrosystemtechnik, LED-Testsysteme). Allerdings adressieren wir nicht Volumenmärkte im Bereich Halbleiterproduktion. Durch die Konzentration auf besondere Anwendungen konnten wir uns eine sehr gute Position am Markt erarbeiten, die zu oben erwähnter, positiver Entwicklung führte. Dennoch war 2005 deutlich spürbar, dass der Hauptwettbewerber und Marktführer, Cascade Microtech in den USA, den Druck am Markt verstärkte.

Innerhalb der Regionen stellt Europa als stärkste Region über 40% des Gesamtgeschäftes dar. In Asien sind wir mit unseren Probern weniger stark vertreten, da hier vor allem Produkte für die Massenfertigung Anwendung finden. Diesen Bereich adressieren wir mit unseren Produkten nur in Randbereichen.

Der Auftragseingang steigerte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr leicht von 28,7 Mio. EUR auf 29,3 Mio. EUR (+2%). Bei den Umsätzen fiel der Zuwachs etwas größer aus, wo mit 28,8 Mio. EUR (Vorjahr: 27,0 Mio. EUR) ein Wachstum von 7% erreicht wurde.



## Segmentübersicht Test Systeme (in Mio. EUR bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt)



Das Segmentergebnis konnte im Jahr 2005 von 1,5 Mio. EUR auf 2,1 Mio. EUR gesteigert werden. Dabei verringerte sich jedoch aufgrund der gestiegenen Wettbewerbsintensität die Rohertragsmarge im Jahresvergleich von 42,3% auf 39,6%. Der Zuwachs beim Segmentergebnis ist vor allem auf um 0,4 Mio. EUR verringerte F&E-Aufwendungen und Verbesserungen bei den sonstigen betrieblichen Erträgen um 0,4 Mio. EUR zurückzuführen.

Die Verringerung des Segmentvermögens (netto) beruht unter anderem auf um 1,0 Mio. EUR verringerten Lagerbeständen sowie auf um 2,1 Mio. EUR erhöhten Kundenanzahlungen.

### • Segment Sonstige

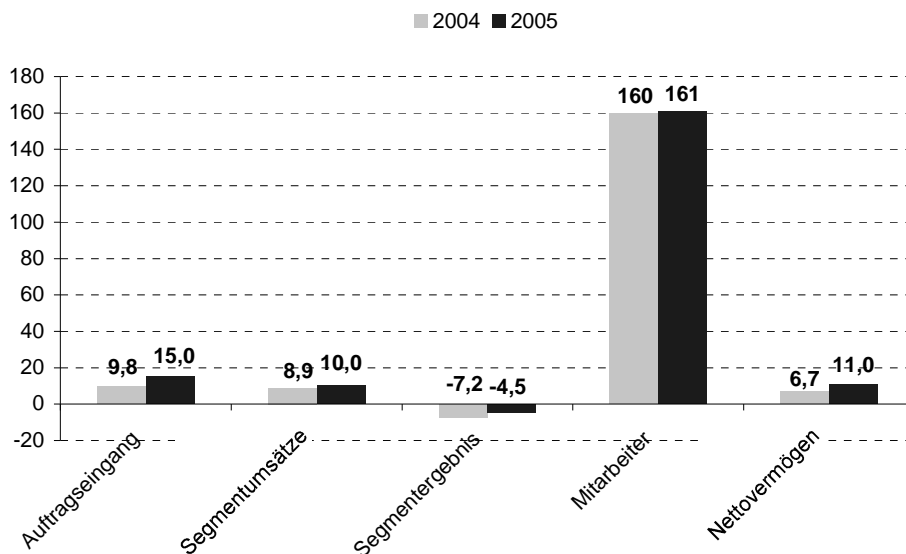
Das Segment Sonstige beinhaltet vor allem unser Geschäft mit den Masken für die Halbleiterindustrie (Palo Alto, Kalifornien/USA). Daneben sind unsere Aktivitäten in der Mikrooptik (Neuchatel, Schweiz) und sonstige Bereiche zugeordnet. Auch das Geschäftsfeld C4NP ist derzeit in diesem Segment berücksichtigt. Sobald C4NP für den Konzern eine entsprechende Bedeutung im operativen Geschäft erreicht, werden wir hierfür ein eigenes Segment bilden. Zum aktuellen Zeitpunkt trägt C4NP jedoch noch keine Umsätze bei, so dass bis auf weiteres keine gesonderte Darstellung erfolgt. Ebenfalls enthalten sind die nicht auf die Segmente zuordenbaren Kosten der Konzernfunktionen.

Die beiden Bereiche Masken und Mikrooptik entwickelten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr positiv. In beiden Fällen konnte ein Umsatzwachstum verzeichnet werden. Während bei den Masken das Segmentergebnis erheblich gesteigert werden konnte, ging dieses bei der Mikrooptik aufgrund der deutlich gesunkenen Rohertragsmarge zurück. Beide Segmente steuerten ein positives Segmentergebnis in den Jahren 2004 und 2005 bei.

Der Ergebnisbeitrag von C4NP war in 2004 und 2005 unwesentlich, da derzeit vor allem zu aktivierende Entwicklungstätigkeiten anfallen.

Einen Großteil der Verwaltungsaufwendungen und damit auch des negativen Segmentergebnisses stellen die Aufwendungen der Konzernholding dar, soweit diese nicht den Segmenten zugeordnet werden.

## Segmentübersicht Sonstige Segmente (in Mio. EUR bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt)



Der Segmentverlust verringerte sich von –7,2 Mio. EUR auf –4,5 Mio. EUR. Die Verwaltungskosten verringerten sich im Jahresvergleich um 2,2 Mio. EUR, wobei im Vorjahr Sondereffekte für die höhere Kostenbasis verantwortlich waren. Die Kosten für das Marketing reduzierten sich 2005 im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Mio. EUR.

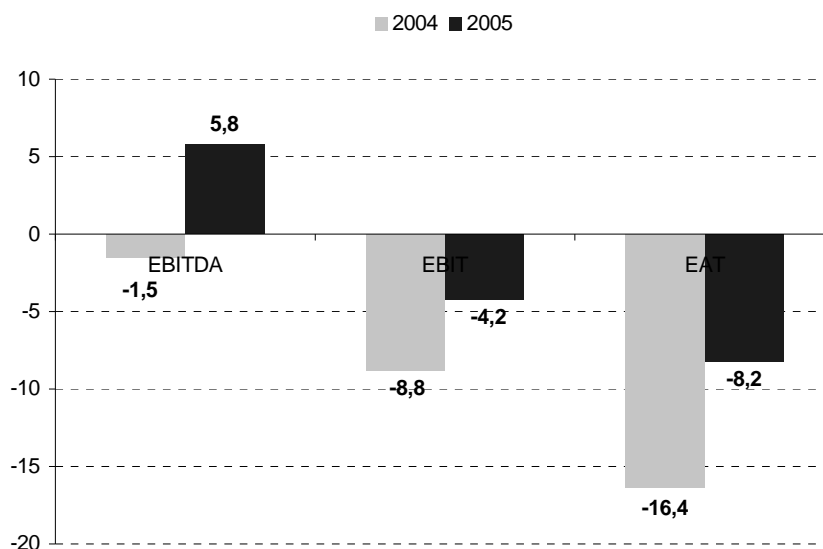
Die Aktivierung der Entwicklungsleistungen für die neue Produktlinie C4NP war weitgehend für die Erhöhung des Nettosegmentvermögens verantwortlich.

## 5. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

### • Ertragslage

Die Ertragssituation bei der SÜSS MicroTec Gruppe ist stärker als bei anderen Unternehmen von der Entwicklung der Umsätze abhängig. So kann ein Umsatzwachstum von z. B. 20% zu einer Ergebnisverbesserung von 40% führen. In unserem Fall führt ein steigender Umsatz bei relativ konstanten Kosten für Verwaltung, Vertrieb sowie Forschung und Entwicklung zu deutlich steigenden Roherträgen. Diese wirken sich direkt auf das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) aus.

### Entwicklung wesentlicher Ergebniskennzahlen in Mio. EUR



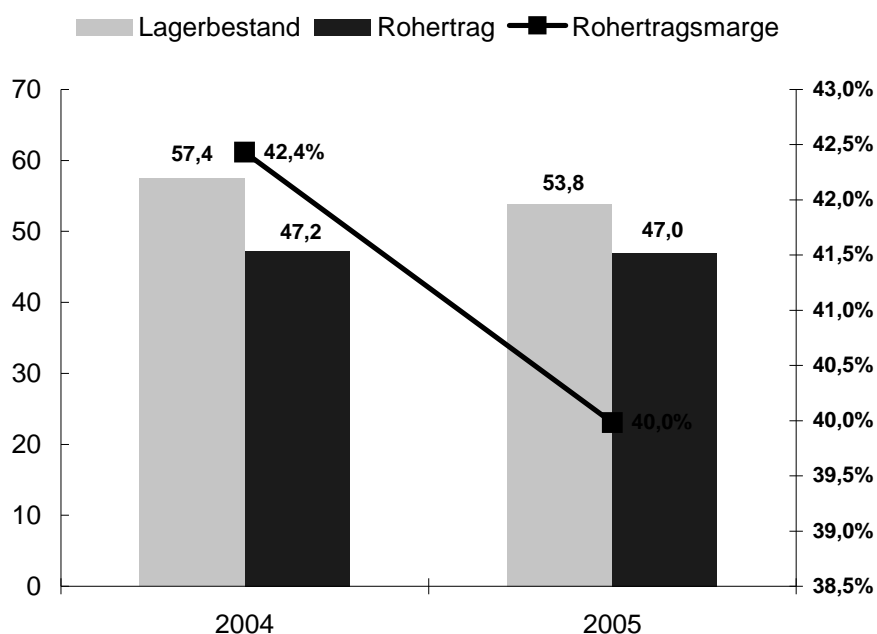
Auch das Jahr 2005 konnte noch nicht die Wende bei der Ergebnisentwicklung bringen. Wie schon in den Jahren davor, haben auch 2005 signifikante Sondereffekte das Ergebnis beeinflusst. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Erläuterungen zu den Segmenten Lithografie und Device Bonder.

Die operative Performance verbesserte sich jedoch deutlich. So konnten wir erstmals seit 2001 ein positives EBITDA von 5,8 Mio. EUR (Vorjahr: - 1,5 Mio. EUR) erwirtschaften.

Rohertrag und Rohertragsmarge entwickelten sich im Jahresvergleich rückläufig. Zudem wirkten sich Teile der oben genannten Sondereffekte negativ auf die operativ erreichten Roherträge aus.

- Der Rohertrag sank von 47,2 Mio. EUR im Vorjahr auf 47,0 Mio. EUR.
- Die Rohertragsmarge sank von 42,4% auf 40,0%.

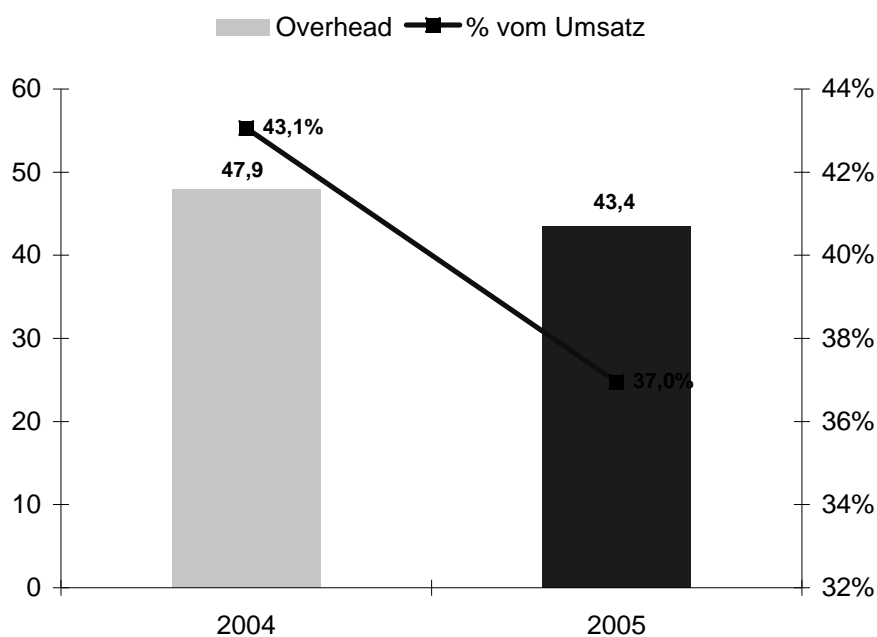
Entwicklung des Lagerbestands und des Rohertrags (in Mio. EUR) sowie der Rohertragsmarge (% vom Umsatz)



Innerhalb der Produktlinien weisen vor allem die Segmente Substrat Bonder und Device Bonder schwache Margen auf, bedingt unter anderem durch geringe Produktreife, Auslastungsprobleme und Wertberichtigungen. In den Segmenten Lithographie und Test Systeme wird die Margenentwicklung dagegen eher durch den Preisdruck beeinflusst.

Erfreulicherweise konnte im Jahresverlauf der Lagerbestand erkennbar zurückgeführt werden. Dieser sank von 57,4 Mio. EUR auf 53,8 Mio. EUR (-6%).

## Entwicklung der Overheadkosten in Mio. EUR und in % vom Umsatz

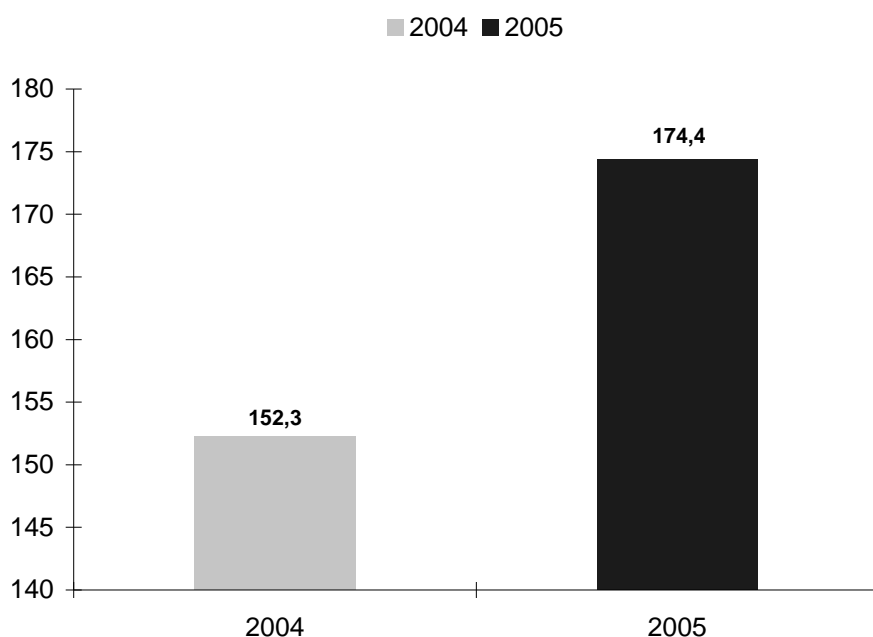


Durch weitere Einsparungen im Jahr 2005 wurden die Kosten für Verwaltung und Vertrieb deutlich von 47,9 Mio. EUR auf 43,4 Mio. EUR (- 9%) gesenkt. Somit ergab sich auch eine signifikant niedrigere Kostenquote (37% in 2005 gegenüber 43% in 2004) im Verhältnis zum Umsatz. Die Einsparungen wurden hauptsächlich durch eine Straffung der Managementstrukturen sowie eine erhebliche Konsolidierung der Marketingaktivitäten erzielt.

Enthalten in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträgen, wurde aufgrund des wieder erstarkten US-Dollars im Jahr 2005 ein Ertrag realisiert (+ 1,0 Mio. EUR), während im Vorjahr noch ein Verlust entstanden war (- 1,2 Mio. EUR).

Beim Steueraufwand wirkten wie im Vorjahr Wertberichtigungen auf aktivierte latente Steuern auf Verlustvorträge und temporäre Differenzen.

## Nettoumsatz je Mitarbeiter in TEUR



Der Nettoumsatz pro Mitarbeiter (auf Jahresendwert gerechnet) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 14% von 152 TEUR auf 174 TEUR.

- **Finanz- und Vermögenslage**

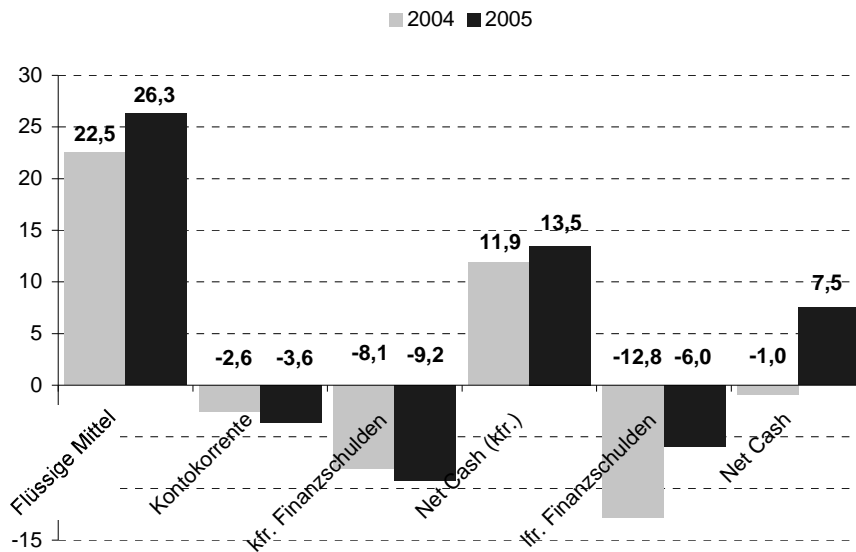
Unser Ziel ist, stets eine ausreichende kurzfristige Liquiditätsreserve für das operative Geschäft zu halten, um einen sprunghaften Auftragsanstieg und damit verbundene hohe Investitionen in das Working Capital finanzieren zu können. Diese Reserve soll grundsätzlich als Barmittel zur Verfügung stehen; Kreditlinien sollen als flankierende Maßnahme dienen. Die zum 31.12.2005 ausgelaufenen Kreditlinien in Deutschland (8,5 Mio. EUR) sollen 2006 in ähnlicher Höhe wieder hergestellt werden.

Der derzeitige Überschuss beim Net Cash wird beibehalten, solange keine wesentlichen Aktivitäten im Bereich Mergers&Acquisitions oder größere Investitionsvorhaben geplant sind. Sofern solche Aktivitäten zum Tragen kämen, würden wir bei zusätzlichem Finanzierungsbedarf auf eine ausreichende Fristigkeit Wert legen. Wir sind überzeugt, dass unsere Finanzierungspolitik wesentlich dazu beigetragen hat, die schwierige Unternehmensentwicklung seit 2002 hinsichtlich der Liquidität und Verschuldung gut zu beherrschen.

Die Liquiditätsentwicklung in 2005 war neben dem Zufluss aus dem operativen Geschäft vor allem durch Aktivitäten innerhalb der Passivseite geprägt. Zum einen wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot durchgeführt, zum anderen wurde der größere Teil der in 2003 begebenen Wandelanleihe getilgt.

Die Liquiditätskennzahlen entwickelten sich im Jahresvergleich positiv. Der Forderungsbestand verringerte sich trotz des gestiegenen Umsatzes, wobei jedoch die Kundenanzahlungen leicht zurück gingen. Insgesamt gehen wir zum Ende des Jahres 2005 deutlich gestärkt in das aktuelle Geschäftsjahr. Die Gesamtsituation bei den Finanzschulden hat sich im Jahresverlauf erheblich verbessert. So hat sich der kurzfristige Liquiditätsüberschuss (Fristigkeit 1 Jahr) von 11,9 auf 13,5 Mio. EUR verbessert. Insgesamt betrug die Net Cash Position zum Jahresende 2005 + 7,5 Mio. EUR (Vorjahr: -1,0 Mio. EUR).

## Entwicklung der Bankguthaben und Finanzschulden in Mio. EUR



Die im ersten Halbjahr 2006 fälligen wesentlichen Tilgungsleistungen, vor allem die zweite Tranche der Wandelanleihe (3,6 Mio. EUR) sowie die Projektfinanzierung der IBM Kreditbank GmbH (2,5 Mio. EUR per 31.12.2005), können aus der bestehenden Liquidität heraus bedient werden.

Beim Working Capital ist insbesondere die Verringerung des Lagerbestandes um 3,6 Mio. EUR hervorzuheben. Dem gegenüber steht eine Reduzierung der sonstigen kurzfristigen Rückstellungen um 2,7 Mio. EUR. Mit der Entwicklung des Lagerbestand in 2005 sind wir zufrieden, wobei sich die Kundenanzahlungsquote – wie erwartet – nicht erhöhte.

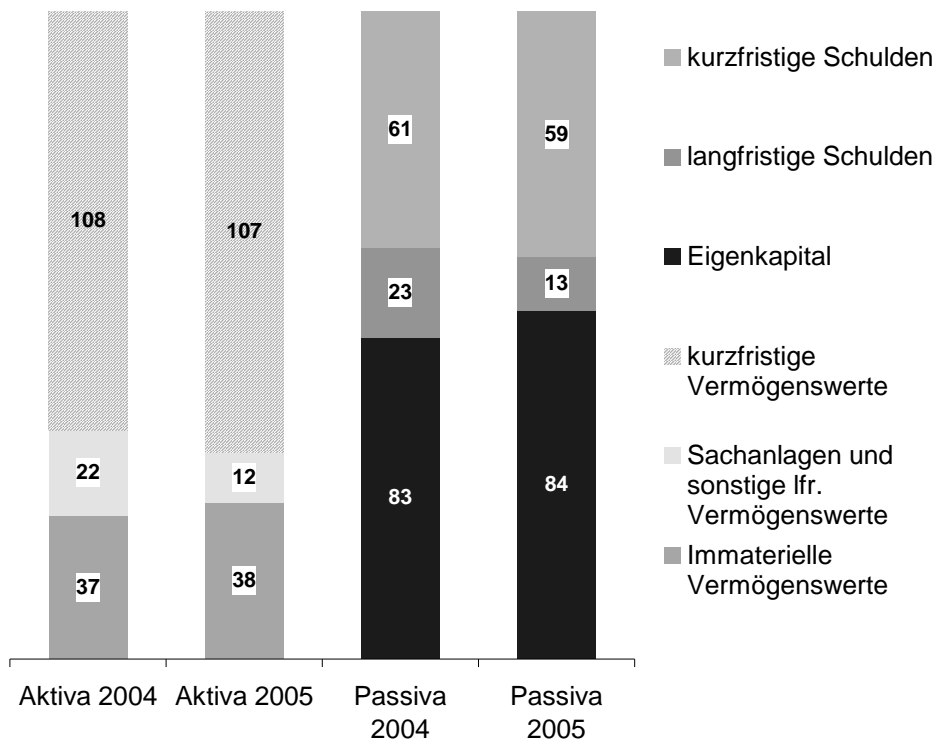
Die wesentlichen Änderungen bei den kurzfristigen Vermögenswerten sind somit auf den erhöhten Barbestand und die verringerten Lagerbestände zurückzuführen. Die Verringerung bei den langfristigen Vermögenswerten ist vor allem auf folgende Ereignisse zurückzuführen:

- Wertberichtigung und Abgang der Immobilie Aßlar 1,7 Mio. EUR
- Wertberichtigung der Immobilie St. Jeoire, Frankreich 1,1 Mio. EUR
- Änderung der latenten Steueransprüche 6,5 Mio. EUR

Durch den wieder erstarkten US – Dollar wurde die Wertberichtigung auf den Geschäfts- oder Firmenwert bei den Device Bondern (1,8 Mio. EUR) teilweise wieder kompensiert.

Die Bilanzstruktur des Konzerns bleibt somit unverändert stabil. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 50% auf 54%.

## Bilanzstruktur Konzern in Mio. EUR



### • Investitionen

Aufgrund der Struktur des Unternehmens sind Investitionen in Sachanlagen keine wesentliche Komponente in der Unternehmensentwicklung. Die wesentliche Wertschöpfung entsteht durch Design, Montage und Justage der Komponenten sowie der entsprechenden Softwaresteuerung. Für diese Tätigkeiten sind keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich. Ausnahmen stellen nur die in dem Segment Sonstige enthaltenen Produktlinien „Fotomasken“ und „Mikrooptik“ dar. In beiden Fällen wird Kleinserienfertigung betrieben, für die entsprechende Fertigungsmaschinen notwendig sind. Investitionen in diesen Bereichen führen unmittelbar zu einem deutlichen Anstieg der Sachanlage-Investitionen im Konzern.

Wir gehen davon aus, dass sich die Investitionen in Sachanlagen weiterhin in einem Bereich von ca. 2 – 3% des Umsatzes bewegen werden.

Während bei Anwendung von US-GAAP Entwicklungsleistungen im Konzern sofort aufwandswirksam verbucht wurden, sind gemäß IFRS bei Erfüllung bestimmter Kriterien Entwicklungsleistungen zu aktivieren und planmäßig abzuschreiben. Da die Entwicklung neuer Produkte eine der wichtigsten Aktivitäten zur Sicherung der nachhaltigen Unternehmensentwicklung repräsentiert, wird unter IFRS ein bestimmter Anteil der Entwicklungsleistungen nun als Investition in immaterielle Vermögenswerte ausgewiesen.

Den größten Anteil an den Investitionen stellte in 2005 die Entwicklung der Maschinen für die C4NP-Technologie dar. Zukünftig erwarten wir, dass von den ca. 8 bis 10 Millionen Euro Ausgaben für Forschung und Entwicklung rund 25 bis 35% aktiviert werden und der verbleibende Betrag aufwandswirksam erfasst wird.

- **Die Holding – Süss MicroTec AG**

*(Hinweis: Den Einzelabschluss der Süss MicroTec AG stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich hierzu an unsere Investor Relations-Abteilung.)*

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Führung des SÜSS MicroTec-Konzerns. Sie übernimmt unter anderem die Aufgaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und der Finanzierung der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding für die Corporate Identity auf den Gebieten Investor Relations und Marketing verantwortlich.

Die Süss MicroTec AG ist in der Regel alleiniger Anteilseigner an den im Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an Tochterunternehmen. Die Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unserer Märkte abhängig. Die Holding refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefähigen Kosten auf die operativen Gesellschaften.

- **Wesentliche Veränderungen bei den Vermögenswerten und Schulden der Holding**

Die Ausleihungen und Forderungen der Muttergesellschaft an verbundene Unternehmen verringerten sich im Jahresvergleich von 46,7 Mio. EUR auf 41,1 Mio. EUR. Diese Verringerung beinhaltet auch die Aufrechnung von Entwicklungsleistungen für C4NP mit bestehenden Verbindlichkeiten.

Aus dem im Vorjahr mit der IBM Deutschland Kreditbank GmbH geschlossenen Darlehensvertrag über eine Darlehenssumme in Höhe von 3,4 Mio. EUR wurde im Geschäftsjahr ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 1,3 Mio. EUR ausbezahlt. Der Darlehensbetrag dient zur Finanzierung der Entwicklung einer Produktionsmaschine gemäß Joint Development Agreement mit der IBM Corporation, USA. Es wurde ein variabler Zinssatz in Höhe des Ein-Monats-Euribors zuzüglich 5,15% p.a. vereinbart. Die Auszahlung des Darlehens richtet sich nach dem Projektfortschritt. Zum Bilanzstichtag waren insgesamt 2,5 Mio. EUR ausgezahlt. Das Darlehen ist spätestens am 30. Juni 2006 vollständig zurückzuführen.

Vertragsgemäß hat die Gesellschaft zum 31. Oktober 2005 einen Teilbetrag aus der im November 2003 begebenen Wandelanleihe in Höhe von 5,6 Mio. EUR zurückbezahlt. Zum Bilanzstichtag beläuft sich der Gesamtbetrag der Wandel- und Optionsanleihe noch auf insgesamt 4,0 Mio. EUR.

Die Gesellschaft hat bei Ausgabe der Wandelanleihe im Jahr 2003 den für das Wandlungsrecht zugeflossenen Betrag als Aufgeld in die Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 2 HGB eingestellt. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem passivierten Rückzahlungsbetrag der Anleihe und dem Ausgabebetrag einer reinen Anleihe ohne Wandlungsrecht wurde unter den Rechnungsabgrenzungsposten als Disagio nach § 250 Abs. 3 S. 1 HGB aktiviert. Das Disagio wird über die Laufzeit der Anleihe aufgelöst und beträgt zum 31. Dezember 2005 noch 0,1 Mio. EUR (i. Vj. 0,7 Mio. EUR).

Das Gezeichnete Kapital wurde am 26. August 2005 aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage um 1,5 Mio. EUR auf € 16,6 Mio. EUR erhöht. Der Bezugspreis für die neuen Aktien betrug EUR 4,70 pro Aktie. Insgesamt ergab sich aus der Kapitalerhöhung ein Brutto-Mittelzufluss von 6,8 Mio. EUR. Der Aufsichtsrat hat dieser Kapitalerhöhung zugestimmt. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2005 vollumfänglich gewinnberichtig. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 6. September 2005.



Infolge der Ausübung von insgesamt 180.000 Bezugsrechten in den im Aktienoptionsplan 2002 vorgesehenen Ausübungszeiträumen wurde das Gezeichnete Kapital aus bedingtem Kapital 2002/II durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage um 0,2 Mio. EUR auf 16,8 Mio. EUR erhöht. Die Anmeldung zur Eintragung ins Handelsregister erfolgte im Januar 2006.

Der kurzfristige Finanzbedarf ist durch die bestehende Barliquidität gedeckt. Diese hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Mio. EUR erhöht.

- **Wesentliche Ereignisse mit Einfluss auf die Ertragslage der Holding**

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der Süss MicroTec AG ergab sich für das Geschäftsjahr 2005 ein Jahresfehlbetrag von - 0,5 Mio. EUR (Vorjahr: -3,4 Mio. EUR).

Im Jahr 2005 wurde der Ergebnisabführungsvertrag mit der Süss MicroTec Test Systems GmbH, Dresden, wirksam. Durch diesen wurden bei der Süss Holding 0,2 Mio. EUR ergebniswirksam.

Sonstige betriebliche Erträge stellten vor allem Fremdwährungsgewinne in Höhe von 3,2 Mio. EUR sowie periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR dar.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen durch die Weiterbelastung von Entwicklungsleistungen in Höhe von 3,6 Mio. EUR im Rahmen des C4NP-Projekts und durch Fremdwährungsverluste in Höhe von 2,3 Mio. EUR geprägt.

In der Süss MicroTec AG waren zum Ende des Geschäftsjahres 2005 16 (Vorjahr: 20) Mitarbeiter und 2 Vorstände aktiv tätig.

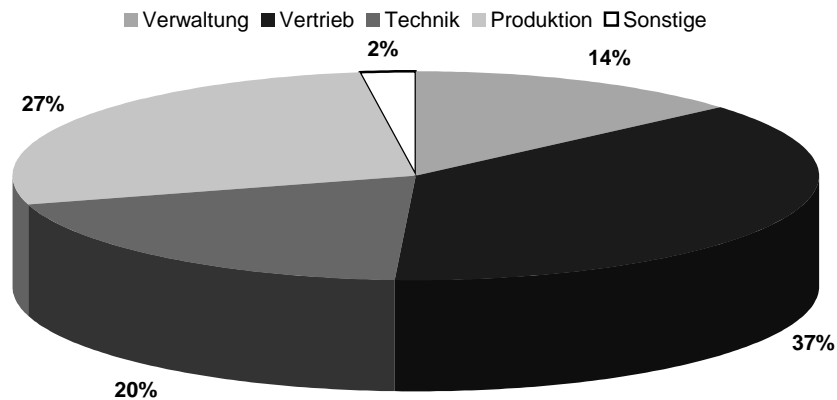
Darstellung der finanziellen Kennzahlen der Holding (TEUR):

Gesellschaft	SMT AG (Handelsrecht)			
	2005	2004	Änderung	in %
Jahresfehlbetrag	-545	-3.417	2.872	-84%
Eigenkapital	99.171	92.215	6.956	8%
Bilanzsumme	115.837	116.575	-738	-1%
EK-Quote in %	86%	79%		
Anlagevermögen	77.877	84.562	-6.685	-8%
...% der Bilanzsumme	67%	73%		
Umlaufvermögen	37.961	32.013	5.948	19%
...% der Bilanzsumme	33%	27%		

- **Mitarbeiter im Konzern**

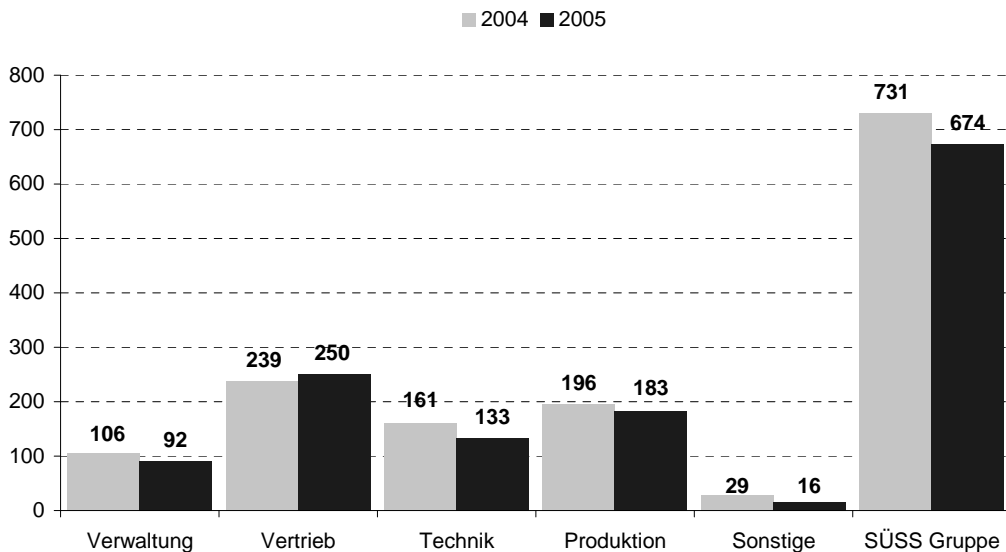
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen stellen einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswertes dar. Auch die Anlernzeiten, insbesondere im technischen Bereich, sind aufgrund der sehr spezifischen Produkte länger als ein Jahr. Daher sind ein motivierendes Umfeld und eine leistungsgerechte Bezahlung Grundvoraussetzungen für die Erhaltung bestehender und die Anwerbung qualifizierter neuer Mitarbeiter.

## Mitarbeiter im Konzern in %



SÜSS MicroTec hat bereits heute einen hohen Anteil der Wertschöpfung in der Herstellung der Produkte nach Außen verlagert. Die Materialquote liegt in der Regel bei 60 – 70%. Daher ist ein wesentlicher Anteil von 57% der Mitarbeiter nicht in der Produktion, sondern im (technischen) Vertrieb, dem Service und in der Vertriebsunterstützung sowie im internen Entwicklungsbereich tätig. Die Mitarbeiter in der Produktion stellen nur 27% der Gesamtbelegschaft dar.

## Entwicklung der Mitarbeiterzahlen nach Bereichen



Zum Ende des Jahres 2005 waren 674 (Vorjahr: 731; -7,8%) Mitarbeiter in den einzelnen Unternehmen des Konzerns beschäftigt. Im Berichtsjahr beeinflussten folgende Maßnahmen die Änderung der Mitarbeiterzahlen:

- Die in 2004 beschlossene Schließung des Werkes Aßlar führte zum Abgang von 39 Mitarbeitern.
- In Teilbereichen wurden in Garching Mitarbeiter aufgebaut, um für die von Aßlar nach Garching verlagerten Aktivitäten ausreichend Kapazitäten bereitstellen zu können.

- Im Rahmen eines Overhead–Kostensenkungsprogramms wurden in mehreren Gesellschaften in den Bereichen Verwaltung und Vertrieb Mitarbeiter abgebaut.
- Im Werk St. Jeoire, Frankreich, wurden im Rahmen einer weiteren Reduktion der Kostenbasis 18 Stellen abgebaut.

Wie bereits im Vorjahr formuliert, ist unser langfristiges Ziel der Aufbau, Erhalt und die Entwicklung einer Stammebelegschaft, der eine weitreichende Perspektive innerhalb der SÜSS MicroTec-Gruppe offeriert werden kann.

## **6. Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage**

Nach dem Jahr 2001 konnte der Konzern bis 2005 kein positives Nachsteuerergebnis mehr erzielen. In dieser Zeit wurde das Personal um etwa 30% abgebaut und darüber hinaus auch Standorte geschlossen. Trotzdem war in dieser Zeit die Finanzlage durchgehend soweit gesichert, dass Liquiditätsengpässe nicht auftraten. Zum Jahresende stellte sich die Finanzlage erneut verbessert dar; wir verfügten zum 31.12.2005 über eine deutlich positive Net Cash – Position.

Die Ertragslage war im abgelaufenen Geschäftsjahr unverändert nicht zufriedenstellend. Jedoch konnten wir bereits ein positives EBITDA erwirtschaften, welches die deutlich verbesserte Ergebnisperformance ausdrückt. Unser Ziel eines ausgeglichenen Ergebnisses haben wir nicht erreicht, unter anderem bedingt durch die erwähnten Sondereffekte.

## **7. Umwelt**

Während in unserem Produktionsprozess kaum umweltbelastende Stoffe Verwendung finden oder entstehen, setzen unsere Kunden in der Produktion von Halbleitern und Mikrosystemen zahlreiche chemische Stoffe ein. Daher ist unser Beitrag zur nachhaltigen Sicherung unserer Umwelt im Wesentlichen von den verwendeten Prozessen und Materialien im Produktionsprozess unserer Kunden abhängig.

Jedoch können wir einen indirekten Beitrag leisten indem wir Maschinen produzieren, die eine Verwendung von umweltfreundlicheren Materialien ermöglichen. Der von IBM entwickelte C4NP-Prozess beispielsweise erlaubt die bleifreie Verarbeitung von Chips.

Darüber hinaus werden unsere Produkte beispielsweise in der Automobilzulieferer-Industrie bei der Produktion von Sensoren eingesetzt, die nachhaltig die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen: Airbags und Antiblockiersysteme sorgen dafür, dass die individuelle Mobilität immer sicherer wird. Aber auch intern spielt die Arbeitssicherheit eine wichtige Rolle: In Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft werden die Mitarbeiter der SÜSS MicroTec regelmäßig zum Thema "Sicherheit am Arbeitsplatz" geschult. Die Reinräume entsprechen den anspruchsvollen Sicherheitsstandards, so dass das Arbeiten mit gefährlichen Chemikalien so risikoarm wie möglich geschehen kann. Für den Notfall sind Mitarbeiter auch in spezifischen Erste-Hilfe-Maßnahmen ausgebildet.

Wir sind überzeugt, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten einen angemessenen Beitrag zur nachhaltigen Sicherung unserer Umwelt leisten.

## **8. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag**

Es haben sich nach dem Bilanzstichtag bis zur Erstellung des Konzernabschlusses keine angabepflichtigen Ereignisse ergeben.

## 9. Risikobericht

Aus der weltweiten Tätigkeit in der Hochtechnologie ergeben sich allgemeine und aktuelle Risiken für das Unternehmen. Der Vorstand hat zur Überwachung von Risiken in geeigneter Weise Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der SÜSS Micro-Tec Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.

- **Allgemeine wirtschaftliche Risiken und Branchenrisiken**

- **Politische Rahmenbedingungen**

- Vor allem das bestehende Konfliktpotenzial im Nahen Osten könnte erheblichen Einfluss auf den Geschäftsverlauf 2006 nehmen. Hinzu kommen Risiken bei der Embargopolitik in mehreren asiatischen Ländern bzw. bei speziellen Kunden der Gruppe, wobei diese Risiken von deutlich geringerem Ausmaß sind.

- **Zyklische Marktschwankungen und Marktentwicklung**

- Die anhaltende Krise des Halbleitermarktes und die schwierige Einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung gehören unverändert zu den größten Risiken des Unternehmens. Diesen Risiken begegnen wir durch die angepassten Strukturen, die bei wieder zunehmender Geschäftstätigkeit vor allem extern - durch Outsourcing - ausgeweitet werden sollen.

- **Marktpositionierung**

- Neue technologische Entwicklungen des Wettbewerbs könnten Teile des Produktportfolios und damit Teile des Potenzials ungeplant obsolet machen, wenn neue Technologien schnellere, effizientere oder günstigere Lösungen für das gleiche Problem bieten würden. Diesem Risiko begegnen wir vor allem durch gezielte Forschung und Entwicklung und durch einen laufenden Abgleich der Entwicklungsplanung mit den wesentlichen Kunden.

- **Abhängigkeit von einzelnen „Know How-Trägern“**

- In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen einzelner Mitarbeiter abhängig, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung. Eine Nichtverfügbarkeit dieser Mitarbeiter für die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird.

- **Betriebliche Risiken**

- **Vermögens- und Ertragslage**

- Sowohl bei Aktivwerten der Holding als auch bei der Konzernbilanz könnten bei anhaltend ausbleibender Ertragskraft signifikante Wertberichtigungen notwendig werden. Diese hätten wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens- und Ertragslage der Muttergesellschaft und des Konzerns, würden aber nicht liquiditätswirksam werden. Durch konzernweit gültige Bewertungsregelungen sollen latente Überbewertungen vermieden werden.

- **Preisdruck und Währungsentwicklung**

- Im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutlicher Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erholenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise nicht mehr erzielt werden können. Diesem Risiko begegnen wir mit einer stetigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Konditionen auch auf Aufträge, um bei sich erholenden Märkten den Kunden gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten. Weniger kontrollierbar ist die aktuell hohe Volatilität vor allem des US-Dollars, da Geschäfte in diesem Währungsraum in der Regel mit unverändertem US-Dollarpreis getätigt werden. Hier haben wir bereits aktiv rea-

giert und werden die anteilige Wertschöpfung in den Vereinigten Staaten kontinuierlich erhöhen. Jedoch kann dies nicht in der Geschwindigkeit erfolgen, wie es derzeit bei der Währungsentwicklung der Fall ist. Ein grundsätzliches Risiko könnte ein weiteres langfristiges Erstarken des EURO gegenüber dem US-Dollar und dem Japanischen Yen bedeuten, da ab einer gewissen Grenze die derzeitige Aufteilung der Wertschöpfung nicht mehr ergebnisoptimal wäre. Kurzfristige Schwankungen gleichen wir in der Regel durch Sicherungsgeschäfte aus. Die Währungssicherung erfolgt bis zu 12 Monate im voraus, wobei grundsätzlich aufgrund der branchenbedingten Unvorhersehbarkeit des Geschäftsverlaufes nur ein Teilbetrag abgesichert wird.

- **Zugang zu Fremdkapital und Zinsänderungsrisiko**

Wir erwarten zukünftig geänderte Rahmenbedingungen in der Fremdkapitalbereitstellung vor allem durch die Einführung von „Basel II“. Die Minimierung der Abhängigkeit, insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital, soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir begegnen diesem Risiko vor allem durch das Ziel, mit entsprechenden Cash Flows auch aus der Optimierung des Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau zu halten. Das Zinsänderungsrisiko ist begrenzt, da die wesentlichen Fremdkapitalpositionen auf Darlehensbeträgen mit festen Zinssätzen basieren.

- **Rechtliche Risiken, insbesondere Haftungsrisiken**

Die Produkte von SÜSS MicroTec werden durch ein umfassendes Risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, kontrolliert und optimiert. Aufgrund des Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anforderungen an die Produktqualität, kann sich das Haftungsrisiko für SÜSS MicroTec erhöhen. SÜSS MicroTec verfügt, neben anderen Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversicherung für die Gruppe, die das potenzielle Risiko soweit möglich limitiert.

- **Gesamtrisiko**

Im Konzern wurden im Geschäftsjahr 2005 keine bestandgefährdenden Risiken identifiziert. Der Fortbestand des Unternehmens war unter Substanz- und Liquiditätsgesichtspunkten zu keiner Zeit gefährdet. Die aktuelle Eigenkapitalausstattung lag weit über dem Risk Adjusted Capital, das den Eigenkapitalanteil darstellt, der zur Deckung potenzieller Verluste mindestens vorgehalten werden muss.

- **Risikomanagement-System**

Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen (KonTraG) ist das Risikomanagement-System seit langem Bestandteil der Unternehmensführung.

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das Risikomanagement bei SÜSS MicroTec auch mit langfristigen (strategischen) Entwicklungen, die sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken können. Auf der Grundlage eines chancenorientierten gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potentiellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr sind wir stets darauf aus, ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz zu erreichen. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

- **Organisation und Dokumentation des Risikomanagements**

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einführung des Risikomanagement-Systems wurde ein Risikomanagement-Beauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt an den Vorstand berichtet.

Das eingerichtete Risikomanagement-System wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung jährlich geprüft.

- **Risikoidentifikation**

Alle berichtspflichtigen Einheiten des Konzerns veranstalten mindestens einmal jährlich einen Workshop, der neben der Retrospektive vor allem auf zukünftige Entwicklungen eingeht. Außerdem dienen die Workshops dazu, die konzernweit einheitliche Bewertungsmethodik sicherzustellen.

Auf Basis dieser Workshops werden vierteljährlich Risikoberichte erstellt, die bekannte Risiken einer kritischen Würdigung unterziehen und neue Themen aufnehmen.

Plötzlich auftretende Risiken werden darüber hinaus unverzüglich an den Risikomanagement-Beauftragten der jeweiligen Einheit gemeldet.

- **Risikobewertung**

Die Bewertung von Risiken erfolgt zum einen durch die Angabe der maximalen Schadenshöhe, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird der Risikowert durch Einbeziehung einer Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt, die entsprechende Gegenmaßnahmen berücksichtigt und, wie auch die Ermittlung der maximalen Schadenshöhe, auf den Kenntnissen und Erfahrungen der Risikobeauftragten beruht und somit stets dem aktuellsten Stand entspricht. Die Angabe des Risikowerts bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kommenden 12 bzw. 24 Monate.

Risiken werden für das Unternehmen als „wesentlich“ eingestuft, wenn sie entweder als Einzelrisiko oder aber kumulativ eine maximale Schadenshöhe von 1 Mio. EUR erreichen oder übertreffen.

- **Risikohandhabung**

Je nach Art des Risikos und der Höhe der Bewertung werden abgestuft Maßnahmen der Risikovermeidung bzw. -minderung getroffen. Dabei orientiert sich das Risikomanagement stets an der einleitend erwähnten Maxime eines chancenorientierten Umgangs mit Risiken.

Die Risikoabwendung und Organisation von Gegenmaßnahmen wird subsidiär durchgeführt. Die Risikoverantwortlichen beziehungsweise die Berichtseinheiten sind zur Entwicklung und Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte Risiken verpflichtet. Sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung ausreichen, fordern sie Hilfe von höheren Ebenen an.

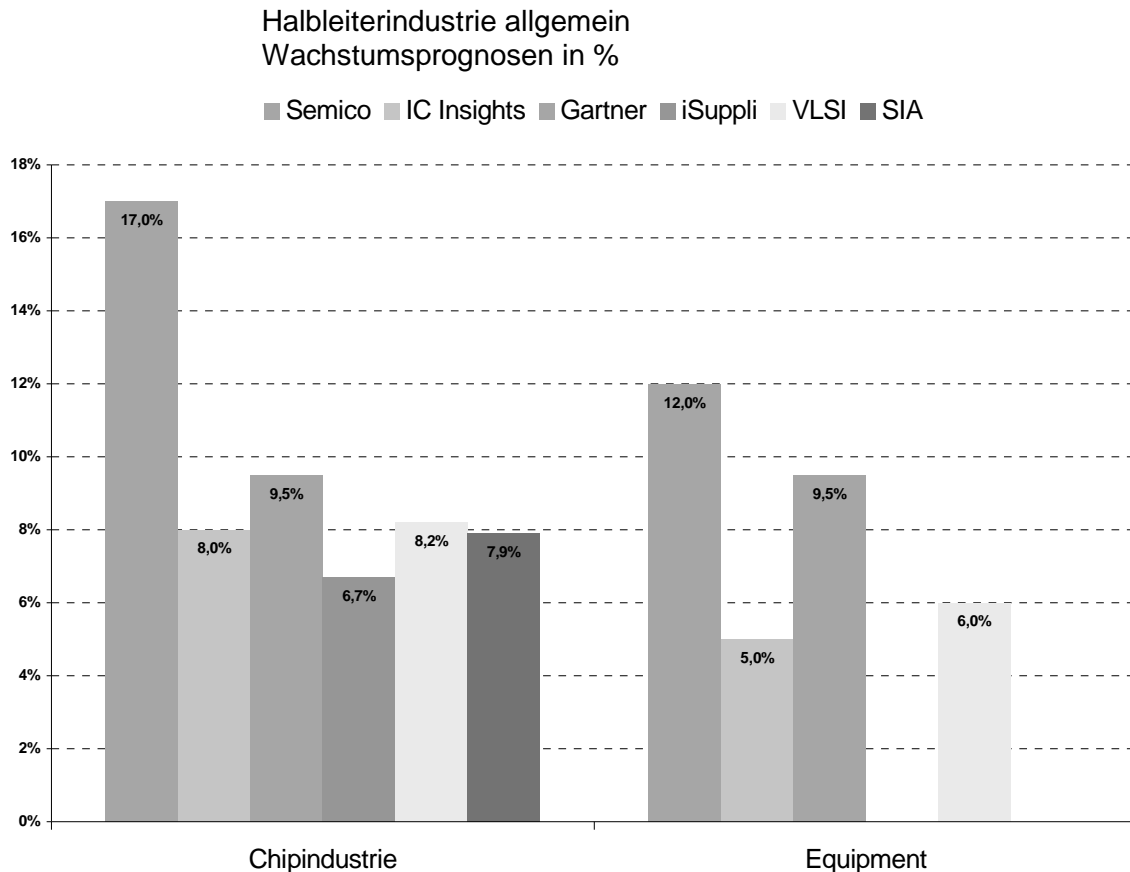
Zur weiteren Minderung unserer Risikoposition wurde bereits Anfang 2004 das bestehende konzernweite Versicherungsprogramm optimiert. Es konnten mit Hilfe eines weltweit agierenden Maklers sowohl hinsichtlich der Versicherungssummen als auch bezüglich des inhaltlichen Versicherungsschutzes deutliche Verbesserungen erzielt werden.

## 10. Prognosebericht

Für das laufende Jahr 2006 zeigen die relevanten Indikatoren derzeit keine grundsätzliche Änderung des Geschäftsumfeldes auf. Dies gilt vor allem für exogene Indikatoren.

- **Halbleiterindustrie allgemein**

So wird bei der Chipindustrie ein weiteres Wachstum auch in 2006 erwartet. Dabei gibt es von den unterschiedlichen Research-Instituten teilweise deutlich abweichende Prognosen:



In der Mehrzahl wird von Wachstumsraten von rund 7-8% in der Chipindustrie, und einem für die Branche moderaten Anstieg bei den Equipment-Herstellern ausgegangen. Jedoch ist die Varianz bei den Vorhersagen für Equipment deutlich größer; diese reichen von 5% bis zu 12% Wachstum. SÜSS wird, wie in der Vergangenheit, nicht direkt von der Entwicklung des Gesamtmarktes abhängen. Jedoch wirkt sich die Stimmung des Gesamtmarktes spürbar auf das Geschäftsklima unserer wesentlichen Kunden aus.

Neben diesen exogenen Indikatoren wollen wir bei den endogenen Indikatoren vor allem auf den Auftragsbestand zum 01.01.2006 hinweisen. Dieser beträgt 85 Mio. EUR nach 66 Mio. EUR zum 01.01.2005 (+ 30%), und bildet eine solide Basis für die Umsatzerwartung der ersten rund 7 bis 9 Monate des laufenden Jahres.

Die Entwicklung in 2005 und auch die Projektionen für 2006 für die Halbleiterindustrie sind möglicherweise auch der Beginn einer Entwicklung zu einer neuen Reifephase. Einige Institute und auch wir gehen davon aus, dass sich die Industrie in dieser Phase auf einem langfristigen Wachstum in der Größenordnung von 10% einpendeln wird. Wesentliche Aussagen aus unserem letzten Lagebericht wollen wir an dieser Stelle nochmals wiederholen:

- Die großen Wachstumsraten bei den Investitionen basierten auf so genannten Killer-Applikationen. Die großen Märkte werden zukünftig mit Wachstumsraten unter 20% erwartet (Quelle: SIA).
- Der Privatkonsument gewinnt immer mehr Bedeutung für die Halbleiterindustrie, und die Schwankungen dieser Konsumentengruppe sind in der Regel deutlich geringer als die der Industriekunden.
- Es wird weiterhin Ausschläge und Volatilitäten geben, jedoch unserer Meinung nach mit deutlich geringeren Amplituden als in der Vergangenheit. So sind durchaus Abweichungen von +/-10% bis +/-20% in Einzeljahren nicht auszuschließen, aber Umsatzsprünge wie in 2000 (+86%) erwarten wir nicht mehr (Angaben gemäß früherer Rechnungslegung US-GAAP).

Darüber hinaus stellten wir im Bereich Mergers&Acquisitions im abgelaufenen Jahr 2005 intensive Aktivitäten fest. Dabei handelte es sich nicht nur um Firmenübernahmen, sondern oftmals um Kooperationen oder potenzielle Ausgründungen von Teilbetrieben. Auch diese Aktivitäten weisen darauf hin, dass die Industrie in die bereits angesprochene neue Reifephase eintritt. Hinsichtlich der Rolle der SÜSS MicroTec hat sich die Situation insoweit verbessert, als dass wir über eine bessere Marktkapitalisierung verfügen, und C4NP eine sinnvolle Diversifikation mit sehr gutem Umsatzpotenzial in unserem Produktportfolio darstellt.

- **Erwartete Entwicklung in den Hauptmärkten:**

- **Advanced Packaging:**

Grundsätzlich erwarten wir in diesem Markt die stärkste Wachstumsdynamik innerhalb der SÜSS Gruppe und somit auch im Segment Lithografie: Fast ausschließlich die Lithografieprodukte adressieren als umsatzstarke Produktionsmaschinen derzeit diesen Markt. Zukünftig soll auch C4NP wesentliche Umsatzbeiträge aus diesem Markt generieren, denn diese Produktlinie findet nur im Advanced Packaging Anwendung.

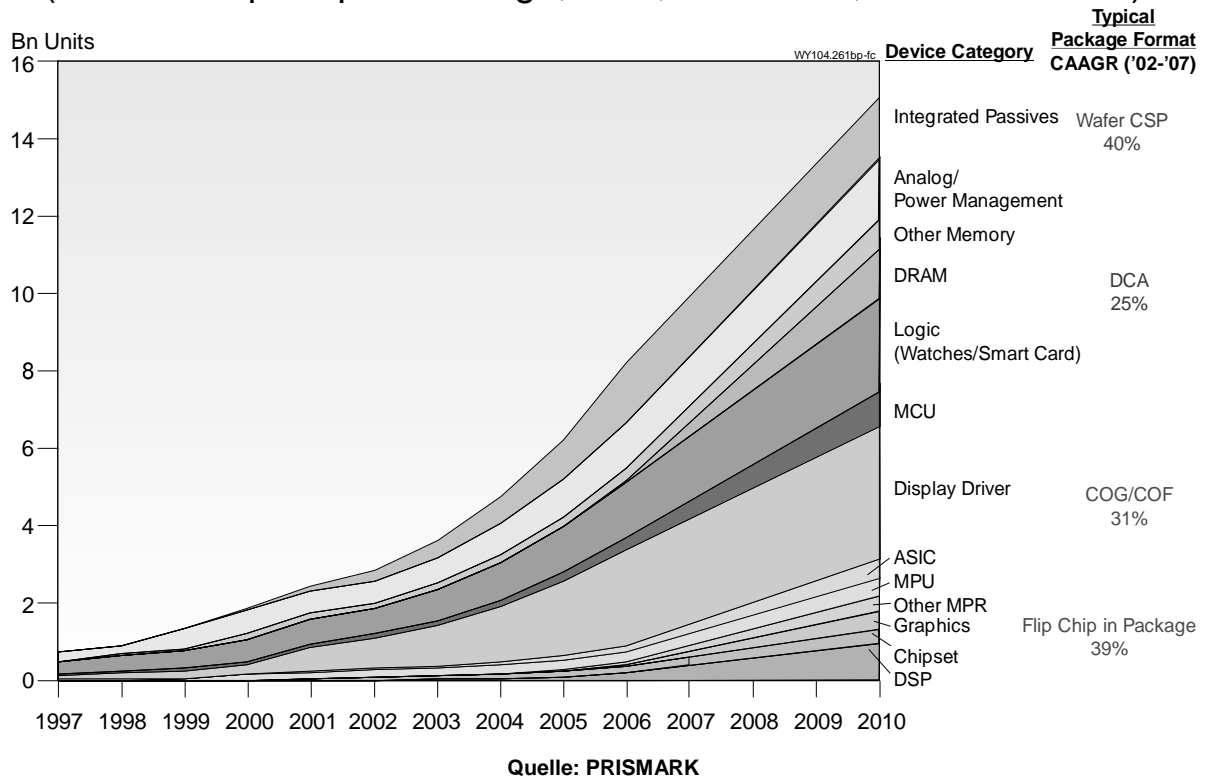
Grund für die erwartete Dynamik ist vor allem, dass dieses Wachstum nicht allein vom Wachstum der Branche abhängt. Vielmehr erwarten wir, dass Advanced Packaging stetig das klassische Wire Bonding bei bestimmten Chiptypen im Zeitverlauf verdrängt. Aufgrund dieser Technologieverdrängung ergeben sich auch Wachstumspotenziale in Zeiten stagnierender oder gar rückläufiger allgemeiner Marktentwicklungen in der Halbleiterindustrie.

Mehrere Research-Institute bestätigen hier unsere Annahme. Während derzeit nur rund 5 – 10% aller Chips mit der modernen Kontaktierungsmethode gefertigt werden, wird bis zum Jahr 2010 eine Verdoppelung dieses Anteils erwartet. Dies bedeutet, dass in den nächsten 3 – 4 Jahren die vorhandene Kapazität für Advanced Packaging – welche vor allem in den letzten 10 Jahren installiert wurde – ebenfalls verdoppelt werden muss. Wir erwarten, dass ein hoher Anteil dieser Kapazitätserweiterung auf 300mm – Fertigungslinien entfällt. Auch gehen wir davon aus, dass unsere gute Wettbewerbsposition bei den asiatischen Auftragsfertigern unverändert bestehen bleibt.

Die nachstehende Grafik zeigt eine Prognose, wie sich die Anwendung der Advanced Packaging Technologie bei verschiedenen Chiparten bis 2010 entwickeln soll.



## GLOBAL CONSUMPTION OF FLIP CHIP DEVICES (Includes Flip Chip in Package, DCA, COF/COG, and Wafer CSP)



Jährliche Wachstumsraten von 10% oder auch deutlich mehr sind in diesem Markt unserer Ansicht nach durchaus möglich. Hinzu kommen weitere Geschäftschancen von erheblicher Bedeutung, die dieses Wachstum nochmals nachhaltig steigern könnten:

Der Speicherchip DRAM wird derzeit fast vollständig mittels Wire Bonding gefertigt; nur ein kleiner Anteil hochwertiger Speicherchips entfällt auf das Advanced Packaging. Die aufkommende Generation der sogenannten DDR3-DRAM stößt bei den Taktfrequenzen in Regionen von 800 Mhz und mehr vor. Im Bereich der CPUs (Hauptprozessoren), die bereits mit Advanced Packaging gefertigt werden, wurde seinerzeit bei diesen Taktfrequenzen der Technologiewechsel vollzogen. Sollte die Massenproduktion von Speicherchips ebenfalls auf das Advanced Packaging wechseln, hätte dies einen erheblichen zusätzlichen Kapazitätsbedarf für Fertigungslinien zur Folge. Der DRAM stellt ein erhebliches Produktionsvolumen dar und würde somit auch für uns eine erhebliche Vergrößerung des adressierbaren Marktes darstellen.

Im obigen Schaubild hingegen ist nur ein geringer Anteil für DRAMs enthalten. Ob der DRAM in der Generation DDR3 den Technologiewechsel zum Advanced Packaging vollzieht, werden wir Ende des Jahres 2006 bzw. Anfang des Jahres 2007 besser beurteilen können. Im Falle einer geplanten Umstellung gehen wir davon aus, dass die DRAM-Hersteller in diesem Zeitfenster auf die Hersteller von Equipment für Advanced Packaging-Fertigungslinien zukommen würden. Grund: Das bereitzustellende Volumen an Equipment für die DRAMs müsste frühzeitig definiert werden, um einer Unterversorgung mit entsprechenden Maschinen vorzubeugen.

Eine weitere Geschäftschance stellt C4NP dar, bei der wir in 2005 bereits den ersten Auftrag für eine Produktionslinie von der IBM Corp. erhalten haben. Mit dieser Produktlinie wird ausschließlich der Markt Advanced Packaging bedient und eine Alternative vor allem zum derzeitigen Verfahren des Electroplatings angeboten. Electroplating findet insbesondere bei feinen Strukturen Verwendung und trifft auf weniger konkurrenzfähige Wettbewerbstechno-

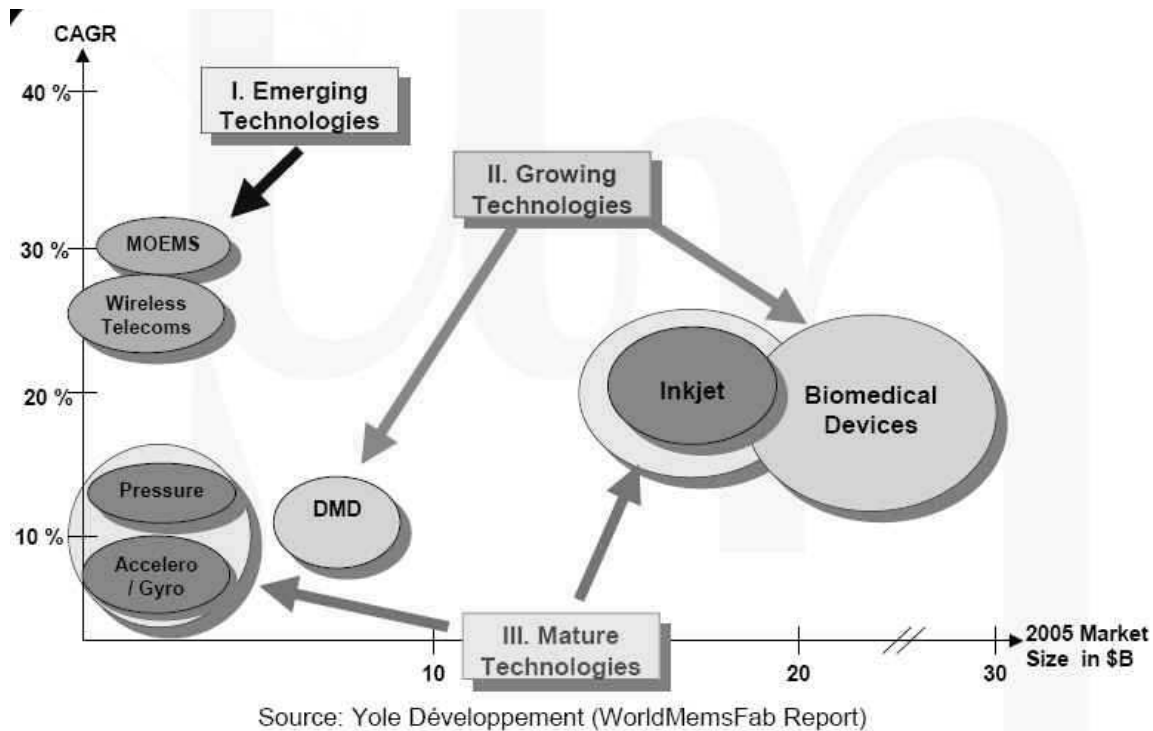
logien. Mit C4NP wird eine völlig andere Verfahrensweise angeboten, die ebenfalls für feine Strukturen geeignet ist. Hinzu kommen Vorteile hinsichtlich der Prozesseigenschaften, unter anderem:

- Kostengünstiges und einfaches Herstellen bleifreier Kontakte
- Flexibilität hinsichtlich Verwendung unterschiedlicher Materialien

Für 2006 erwarten wir ein weiterhin gutes Umfeld im Advanced Packaging, wie es bereits 2004 und 2005 der Fall war. So waren die ersten drei Quartale im abgelaufenen Jahr zwar zurückhaltend, jedoch verlief das vierte Quartal im Auftragseingang positiv. Bezüglich C4NP ist das wesentliche Ziel, in 2006 sogenannte „early adopters“ nach der Bestellung durch IBM selbst für dieses Produkt zu gewinnen. Die Technologie ist zukunftsweisend und neu; auch das Interesse der potenziellen Kunden ist unverändert hoch. Der langfristige Markterfolg hängt letztlich vor allem von der Akzeptanz durch Schlüsselunternehmen in der Industrie ab. Daher wird 2006 auch dahingehend bedeutsam, welche Kunden für C4NP gewonnen werden können.

○ **Mikrosystemtechnik:**

Die Mikrosystemtechnik weist eine hohe Diversifizierung auf, sowohl bei den Produkten selbst, als auch bei den Herstellern der Produkte. Im Gegensatz zum Mikrochip, der in der Regel in großen Stückzahlen extrem kostengünstig gefertigt wird, sind bei den Mikrosystemen die Stückzahlen oftmals geringer und die Variantenvielfalt deutlich höher. Die Mikrosystemtechnik hängt nicht von einzelnen Endmärkten ab, sondern wird vielmehr durch die allgemeine Konjunktur und das Investitionsklima generell beeinflusst.



Die derzeit größten Anteile für die Mikrosystemtechnik stellen Anwendungen in der Automobilindustrie und der Computer-Peripheriegeräte, z.B. Tintenstrahldrucker, dar. So repräsentieren Druck- und Beschleunigungssensoren (zum Beispiel Airbagsensoren) sowie Druckerköpfe für Tintenstrahldrucker derzeit jeweils rund 30% aller Mikrosysteme. Darüber hinaus entfallen weitere knapp 20% auf die Mikrospiegel für Rückprojektions-TV. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Mikrosystemen ergeben sich stets neue adressierbare Märkte, so dass wir langfristig von einem Wachstum für unser Unternehmen von 5

– 10% in diesem adressierten Markt ausgehen. Insbesondere Anwendungen in der Biomedizin wird ein großes Potenzial innerhalb der Mikrosystemtechnik zugeschrieben (siehe Bild).

Ein Wachstum in diesem Markt wird SÜSS vor allem in den Segmenten Lithografie und Substrat Bonder zugute kommen.

Besondere Geschäftschancen in der Mikrosystemtechnik existieren in zwei Fällen: Zum einen sind wir mit unseren Produkten in der Rückprojektionstechnik vertreten (im Bild als „DMD“ bezeichnet). Diese konkurriert mit den anderen modernen TV-Technologien, LCD und Plasma. Sollte diese Technologie im Vergleich zu den beiden anderen Verfahren einen höheren Marktanteil bei den handelsüblichen Fernsehgeräten erzielen, könnte sich ein merklich gesteigertes Umsatzpotenzial für die Substrat Bonder ergeben.

Darüber hinaus ergeben sich möglicherweise Umsatzpotenziale in der Nanotechnologie. Diese wird derzeit oft in Medien und Fachpresse erwähnt; der von SÜSS adressierbare Markt ist derzeit aber noch relativ klein. Wir gehen jedoch davon aus, dass wir zukünftig an einer Vergrößerung des Marktes partizipieren werden. Eine qualifizierte Potenzialabschätzung ist heute noch nicht möglich.

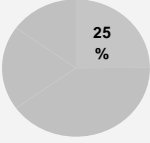
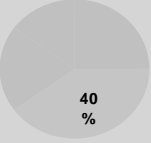
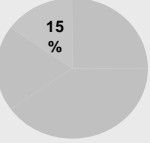
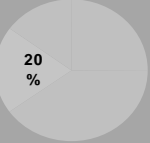
Für 2006 erwarten wir keine wesentliche Änderung der Entwicklung des Marktes Mikrosystemtechnik, so dass wir von einem nachhaltigen und stetigen Wachstum unserer Umsätze in diesen Märkten ausgehen. Insbesondere die Substrat Bonder sollten in 2006 höhere Umsätze erzielen als in 2005, was unter anderem auf den höheren Auftragsbestand zu Beginn des laufenden Jahres zurückzuführen ist.

- **Der Markt Verbindungshalbleiter sowie Markt für Test Systeme:**

Bei den Verbindungshalbleitern ist die zukünftige Marktentwicklung für unsere Produkte unverändert schwierig einzuschätzen. Seit 2002 fehlen Impulse im Bereich der Telekommunikation. Aktuell bietet sich vor allem Geschäftspotenzial bei der Optoelektronik, insbesondere im Bereich LED.

Die Produktlinie der Testsysteme bietet Geräte für Anwendungen im analytischen Bereich der Entwicklung, der Fehleranalyse, sowie MEMS und LED-Probing an. Dieses Segment entwickelt sich relativ stabil und auch relativ unabhängig von den Zyklen der Halbleiterindustrie.

## 11. Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns

Markt	Advanced Packaging	Mikrosystemtechnik	Verbindungs- halbleiter	Test Systeme
<b>Segment</b>				
<b>Umsatzanteil am Gruppenumsatz</b>	 25 %	 40 %	 15 %	 20 %
<b>Lithographie</b>	zusammen > 10%	~ 10%	5-10%	
<b>C4NP</b>				
<b>Substrat Bonder</b>		> 10%		
<b>Device Bonder</b>		Re-Evaluierung		
<b>Test Systeme</b>				~ 5%

Für die Gruppe insgesamt zielen wir auf eine durchschnittliche Wachstumsrate von rund 10% beim Umsatz ab. Wir erwarten neben üblichen Kapazitätserweiterungen durch Installation neuer Fertigungslinien zukünftig ebenfalls vermehrt nachhaltige Umsatzbeiträge aufgrund von Ersatzinvestitionen. So konnten wir bereits im Verlauf des Jahres 2005 Ersatzinvestitionen bei einzelnen Großkunden feststellen, wo vor allem höhere Anforderungen an die Spezifikation sowie erhöhte Durchsatzleistung der neueren Maschinen für den Austausch bestehenden Equipments ausschlaggebend waren.

Weiterhin soll die Rohertragsmarge langfristig auf 45 – 47% erhöht werden, wobei auch die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung wieder bis zu 10% des Umsatzes darstellen sollen. Mit gegebenem Umsatzwachstum und relativ geringem Kostenwachstum bei Vertrieb und Verwaltung soll die Gruppe in die Lage versetzt werden, wieder EBIT-Margen (bezogen auf den Umsatz) von 10% zu erreichen. Gestützt durch eine solche Ergebnisperformance soll das operative Geschäft ausreichend freien Cash Flow generieren, so dass für das organische Wachstum im Grundgeschäft kein zusätzlicher Liquiditätsbedarf entstehen sollte.

Mit Bezug auf die regionale Aufteilung stellten wir in 2005 eine annähernd gleiche Aufteilung auf Europa, Nordamerika und Asien fest. Dennoch erwarten wir unverändert, dass langfristig Asien, bedingt durch den Schwerpunkt Advanced Packaging, überproportional wachsen wird.

Auf Basis des aktuellen Auftragsbestandes sowie der Geschäftsentwicklung und des Investitionsklimas zu Beginn des Jahres 2006, erachten wir ein Umsatzwachstum im Rahmen der Branchenerwartung von bis zu 10% derzeit als erreichbar. Dennoch kann erst mit Beginn des dritten Quartals 2006 eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr abgegeben werden, so dass wir an dieser Stelle auf die Unverbindlichkeit dieser Aussage explizit hinweisen. Sofern der Umsatz 2006 10% über dem Umsatz von 2005 liegt, erwarten wir eine EBIT-Marge von ca. 5%. Der Break Even-Umsatz auf EBIT-Basis liegt derzeit bei etwa 108 bis 110 Mio. EUR und beinhaltet auch die Kostenblöcke, die im Rahmen des Geschäftsaufbaus für C4NP anfallen.

Weitere Maßnahmen zur signifikanten Senkung des Break Even-Punktes sind derzeit nicht geplant. Jedoch bleibt das Segment Device Bonder weiterhin unter sorgfältiger Beobach-

tung. Derzeit ist nicht gesichert, ob ein ausreichend großer, adressierbarer Markt für das entsprechende Produkt Device Bonder existiert. Solange ein solcher Markt nicht definiert ist, kann es unverändert zu strategischen Entscheidungen bezüglich dieses Segmentes kommen.

## **12. Vorausschauende Aussagen**

Dieser Lagebericht enthält Angaben und Prognosen, die sich auf die zukünftige Entwicklung des SÜSS Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder Risiken - wie die im Risikobericht angesprochenen - eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Garching, 15. März 2006

Der Vorstand

Dr. Stefan Schneidewind

Stephan Schulak

## Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss --bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang-- unter Einbeziehung der Buchführung der Süss MicroTec AG, Garching, und ihren Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.



Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

München, 15. März 2006

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schumacher  
Wirtschaftsprüfer

Querfurth  
Wirtschaftsprüfer